



OSTBAYERISCHE
TECHNISCHE HOCHSCHULE
REGENSBURG

Modulhandbuch

für den
Bachelorstudiengang

Mikrosystemtechnik
(B.Sc.)

SPO-Version ab: Wintersemester 2018

Sommersemester 2018

erstellt am 26.07.2018

von Sabrina Hildebrand

Fakultät Allgemeinwissenschaften
und Mikrosystemtechnik

Modulliste

Studienabschnitt 1:

Allgemeine und Anorganische Chemie mit Praktikum (General and Inorganic Chemistry with Laboratory Exercises).....	4
Allgemeine und Anorganische Chemie (General and Inorganic Chemistry).....	5
Praktikum Allgemeine und Anorganische Chemie (General and Inorganic Chemistry Laboratory Exercises).....	9
Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtmodule (General Scientific Elective Modules).....	11
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 1 (General Scientific Elective Module 1).....	13
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 2 (General Scientific Elective Module 2).....	14
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 3 (General Scientific Elective Module 3).....	15
Elektronische Bauelemente (Electronic Circuit Elements).....	16
Elektronische Bauelemente (Electronic Circuit Elements).....	17
Informationsverarbeitung mit Praktikum (Information Processing with Laboratory Exercises).....	19
Informationsverarbeitung (Information Processing).....	20
Praktikum Informationsverarbeitung (Laboratory Exercises: Information Processing).....	23
Mathematik 1 (Mathematics 1).....	26
Mathematik 1 (Mathematics 1).....	27
Mathematik 2 (Mathematics 2).....	30
Mathematik 2 (Mathematics 2).....	31
Technische Physik 1 (Engineering Physics 1).....	35
Technische Physik 1 (Engineering Physics 1).....	36
Technisches Englisch (Technical English).....	39
Technisches Englisch (Technical English).....	40
Werkstoffe 1 (Materials Sciences 1).....	42
Werkstoffe 1 (Materials Sciences 1).....	43

Studienabschnitt 2:

Analogtechnik (Analogue Circuit Design).....	51
Analogtechnik (Analogue Circuit Design).....	52
Bachelorarbeit (Bachelor's Thesis).....	54
Bachelorarbeit.....	55
Berufsvorbereitendes Praktikum (Vocational Preparation Internship).....	46
Praktikum (Internship).....	47
Praxisseminar (Seminar of Practical Course).....	49
Defektdichte-Engineering.....	57
Defektdichte-Engineering.....	58
Digitaltechnik mit Praktikum (Digital Electronics with Laboratory Exercises).....	60
Digitaltechnik (Digital Electronics).....	61
Praktikum Digitaltechnik.....	62
Fachbezogenes Wahlpflichtmodul 1 (Mandatory Subjects specific Elective Module 1).....	63
Analytische Chemie (Analytical Chemistry).....	64
Rastermikroskopie (Scanning Microscopy).....	66
Security Studies.....	68
Sensorprinzipien (Fundamental Principles of Sensor Technology).....	70
Sensors in Biotechnology.....	72
Technikfolgenabschätzung (Technology Assessment).....	74
Fachbezogenes Wahlpflichtmodul 2 (Mandatory Subjects specific Elective Module 2).....	76
Bioanalytik und Genanalytik (Bioanalysis and Genetic Analyses).....	77
Kernphysikalische Methoden in Sensorik und Analytik (Methods of Nuclear Physics in Sensorics and Analysis).....	79
Optische Sensorik (Optical Sensors).....	82

Projektarbeit (Project Work).....	85
Spurenanalytik auf Siliziumscheiben (Trace Analysis on Silicon Wafers).....	87
Technische Optik (Applied Optics).....	90
Festkörperphysik 1 (Solid State Physics 1).....	92
Festkörperphysik 1 (Solid State Physics 1).....	93
Festkörperphysik 2 (Solid State Physics 2).....	96
Festkörperphysik 2 (Solid State Physics 2).....	97
Konstruktion (Mechanical Component Design).....	99
Konstruktion (Mechanical Component Design).....	100
Mess- und Prüftechnik mit Praktikum (Engineering Metrology and Test Engineering with Laboratory Exercises).....	102
Mess- und Prüftechnik (Engineering Metrology and Test Engineering).....	103
Praktikum Mess- und Prüftechnik (Laboratory Exercises: Engineering Metrology and Test Engineering).....	105
Mikroelektroniktechnologie mit Praktikum (Microelectronics Technology with Laboratory Exercises).....	107
Mikroelektroniktechnologie (Microelectronics Technology).....	108
Praktikum Mikroelektroniktechnologie (Laboratory Exercises: Microelectronics Technology).....	111
Mikromechanik (Micromachining).....	113
Mikromechanik (Micromachining).....	114
Optoelectronics.....	117
Optoelectronics.....	118
Packaging (Electronics Packaging).....	121
Packaging (Electronics Packaging).....	122
Physikalische Chemie mit Praktikum (Physical Chemistry with Laboratory Exercises).....	125
Physikalische Chemie (Physical Chemistry).....	126
Praktikum Physikalische Chemie (Laboratory Exercises: Physical Chemistry).....	129
Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen (Internship Support Module).....	131
Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen (Internship Support Module).....	132
Qualitätsmanagement (Quality Management).....	134
Qualitätsmanagement (Quality Management).....	135
Regelungstechnik und Signalverarbeitung (Control Engineering and Signal Processing with Laboratory Exercises).....	
Regelungstechnik und Signalverarbeitung (Control Engineering and Signal Processing with Laboratory Exercises).....	
Systemintegration und Simulation (Systems: Integration and Simulation).....	137
Systemintegration und Simulation (Systems: Integration and Simulation).....	138
Technische Physik 2 mit Praktikum (Engineering Physics with Laboratory Exercises).....	140
Praktikum Technische Physik 2 (Engineering Physics 2).....	141
Technische Physik 2 (Engineering Physics 2).....	143
Vakuumtechnik (Vacuum Physics and Technology).....	145
Vakuumtechnik (Vacuum Physics and Technology).....	146
Werkstoffe 2 (Material Sciences 2).....	149
Werkstoffe 2 (Material Sciences 2).....	150

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Allgemeine und Anorganische Chemie mit Praktikum (General and Inorganic Chemistry with Laboratory Exercises)		CHP / Nr.2
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. und 2.	1.	Pflicht	9

Verpflichtende Voraussetzungen
Zulassungsvoraussetzung für das <i>Praktikum Allgemeine und Anorganische Chemie</i> (Teilmodul Nr. 2.2 / PCH): bestandene Prüfung im Teilmodul <i>Allgemeine und Anorganische Chemie</i> (Teilmodul Nr. 2.1 / CH)
Empfohlene Vorkenntnisse
Grundlagen chemischen Rechnens

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseiten

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Allgemeine und Anorganische Chemie (General and Inorganic Chemistry)	4 SWS	6
2.	Praktikum Allgemeine und Anorganische Chemie (General and Inorganic Chemistry Laboratory Exercises)	2 SWS	3

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Allgemeine und Anorganische Chemie (General and Inorganic Chemistry)		CH
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Alfred Lechner	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	4 SWS	deutsch	6

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	120h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Atommodelle

- * Rutherford
- * Bohr
- * Quantenmechanik
- * Quantenzahlen

Periodensystem der Elemente

- * Metallcharakter
- * Ionisierungsenergie
- * Ionenradien
- * Elektroaffinität
- * Elektronegativität

Chemische Bindung

- * Oktett / Duett - Regel
- * Reaktionswärme
- * Ionenbindung
- * Atombindung
- * Lewisformeln
- * Valence-Bond-Theorie
- * Molecular-Orbital-Theorie
- * Komplexbindung
- * Valence-Bond-Theorie
- * Ligandenfeld-Theorie
- * Metallbindung
- * Elektronengas
- * Bändermodell
- * Halbleiter Metall Isolatoren
- * Wasserstoffbrückenbindung
- * Van der Waals - Bindung

Chemische Reaktion

- * Chemisches Gleichgewicht
- * Massenwirkungsgesetz
- * Löslichkeitsprodukt
- * Redoxsysteme
- * Oxidationszahlen
- * Redoxgleichungen
- * Galvanisches Element
- * Spannungsreihe der Elemente
- * Herstellung von Metallen
- * Säure-Base-Systeme
- * Brönsted-Theorie
- * pH-Wert
- * Säurekonstante
- * Basenkonstante
- * Verschiedene Säuren und Basen

Chemie der 4. Hauptgruppe

- * Kohlenstoff
- * Graphit und Diamant
- * Silicium
- * Sauerstoffverbindungen
- * Wasserstoffverbindungen

- * Reinstsilicium
- * Germanium und Blei
- Chemikalien in der Halbleitertechnologie**
- * Wasserstoffperoxid
- * Chlorwasserstoff
- * Ammoniak
- * Cholin
- * Schwefelsäure
- * Fluorwasserstoff
- * Ammoniumfluorid
- * Verschiedene Lösungsmittel
- Metallische Werkstoffe**
- * Legierungen
- * Mischkristalle
- * Gibbsche Phasenregel
- * Phasendiagramm des Eutektikums ohne Mischkristallbildung
- * Phasendiagramm für vollständige Löslichkeit im flüssigen und festem Zustand
- * Phasendiagramm mit Mischkristallbildung
- * Phasendiagramm des Peritektikums
- * Beispiele: Blei-Zinn, Eisen-Kohlenstoff, Kupfer-Legierungen, Aluminium-Legierungen
- Halbleiter**
- * Energiebändermodell
- * Darstellung von Reinstsilicium
- * Einkristallzucht aus der Schmelze
- * Impfkristall, Millersche Indizes
- * Waferherstellung, Reinigungen
- * III/V - Halbleiter
- * Anwendungen
- Kunststoffe**
- * Arten der Kunststoffe
- * Thermoplaste
- * Duroplaste
- * Herstellungsverfahren und Reaktionsmechanismen
- * Eigenschaften der Kunststoffe
- * Bearbeitungsverfahren
- Werkstoffprüfungen**
- * Kunststoffe
- * Metalle

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Kenntnis der Grundlagen der allgemeinen und anorganischen Chemie.
- Die Studierenden kennen die 4 Quantenzahlen: die Hauptquantenzahl, der Nebenquantenzahl, die magnetische Nebenquantenzahl und die magnetische Spin-Quantenzahl.
- Sie kennen den Aufbau des Periodensystems der Elemente mit Hilfe der 4 Quantenzahlen.

- Sie kennen die 4 starken chemischen Bindungen: Ionen-Bindung, Atombindung, Metallbindung und Koordinationsbindung.
- Sie kennen die schwachen Bindungen: Van der Waals-Bindungen und Wasserstoffbrückenbindungen.

- Sie kennen die anorganischen-chemischen Reaktionen: Redox-Reaktion, Säure-Basen-Reaktion

Kompetenzen:

- Kompetenz zur Anwendung des Periodensystems der Elemente: z.B. sind die Studierenden in der Lage auf Grund des Standes des Elements im Periodensystem die Eigenschaften vorauszusagen.
- Kompetenz zur selbständigen Lösung chemischer Gleichungssysteme.
- Die Studierenden sind in der Lage zur indirekten Bestimmung der Reaktionsenergie.

Angebotene Lehrunterlagen

Skript: Allgemeine und Anorganische Chemie, OTH Regensburg 2017

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer, chemische Anschauungsversuche

Literatur

- Erwin Riedel, Allgemeine und Anorganische Chemie, de Gruyter Verlag
- Erwin Riedel, Willm Grimmich, Atombau, Chemische Bindung, Chemische Reaktion, Grundlagen in Aufgaben und Lösungen, de Gruyter Verlag

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Das Bestehen der Prüfung gilt als Zulassungsvoraussetzung für das Praktikum (Modul Nr. 2.2 / PCH)

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Praktikum Allgemeine und Anorganische Chemie (General and Inorganic Chemistry Laboratory Exercises)		PCH
Verantwortliche/r	Fakultät	
Christine Rieger (LBA)	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Christine Rieger (LBA)	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Praktikum		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
2.	2 SWS	deutsch	3

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	60h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Praktischer Leistungsnachweis (m.E.): Antestat und Testat müssen für jeden Versuch bestanden sein Zulassungsvoraussetzung: bestandene Prüfung im Modul <i>Allgemeine und Anorganische Chemie</i> (Nr. 2.1 / CH).
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
Praktikumsversuche zu folgenden Themen: <ul style="list-style-type: none"> • Gemenge und Verbindung • Säure-Base-Titration • Redoxreaktionen - Spannungsreihe • Gravimetrie • Nachweisreaktionen (qualitative Analyse)
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Die in der Vorlesung Allgemeine und Anorganische Chemie vermittelten Kenntnisse werden in dieser Lehrveranstaltung durch praktische Versuche vertieft. Fertigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden können mit den typischen Gerätschaften der Chemie umgehen und grundlegende praktische Labortätigkeiten durchführen.

Kompetenzen:

- Die Studierenden sind in der Lage, theoretische Zusammenhänge im Kontext praktischer Problemstellungen anzuwenden.
- Befähigung zum Grundverständnis der weiterführenden Vorlesungen „Analytische Chemie“ (3. Semester), „Instrumentelle Analytik“ (4. Semester) und „Umweltanalytik“ (6. Semester) für den Studiengang Sensorik und Analytik. Sowie die Vorlesung "Spurenanalytik" und das Praktikum Mikrotechnologie (3. Semester) im Studiengang Mikrosystemtechnik und der Physikalischen Chemie (6. Semester) in beiden Studiengängen.

Angebotene Lehrunterlagen

Versuchsprotokolle

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- G. Schwedt, Analytische Chemie -Grundlagen, Methoden und Praxis, Thieme Verlag, 2. Auflage, 2008
- Jander/Blasius, Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganischen Chemie, Hirzel, Stuttgart; Auflage: 16., überarb. A. (1. März 2006)
- M. Otto, Analytische Chemie, Wiley-VCH, 4. Aufl., 2011
- Gerdes, Eberhard, Qualitative Anorganische Analyse: Ein Begleiter für Theorie und Praxis, Springer, Berlin; Auflage: 2., korr. u. überarb. A. 2013
- Riedel, Erwin, Allgemeine und Anorganische Chemie, de Gruyter Berlin; 11. Auflage 2013

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Allgemeinwissenschaftliche Wahlpflichtmodule (General Scientific Elective Modules)		AW / Nr.9
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Gabriele Blod	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. oder 2.	1.	Wahlpflicht	6

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine. Ausnahmen sind bei Sprachkursen höheren Niveaus oder Fächer von aufeinander aufbauenden Zusatzausbildungen möglich.
Empfohlene Vorkenntnisse
Keine. Ausnahmen sind bei Sprachkursen höheren Niveaus oder Fächer von aufeinander aufbauenden Zusatzausbildungen möglich.

Inhalte
Je nach Lehrveranstaltung
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Die Studierenden erwerben Wissen über allgemeinwissenschaftliche Themen – je nach dem gewählten Fach in den Bereichen: Orientierungswissen: Horizont erweitern, fachliches Wissen außerhalb des Fachstudiums erwerben (z.B. BWL, Recht, Technik) Soft Skills: persönliche, soziale und methodische Kompetenz erwerben Sprachen: Fremdsprachen verstehen, sprechen, schreiben

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 1 (General Scientific Elective Module 1)	2 SWS	2
2.	Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 2 (General Scientific Elective Module 2)	2 SWS	2
3.	Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 3 (General Scientific Elective Module 3)	2 SWS	2

Hinweise zur Belegungspflicht oder zu Optionen

Nähere Informationen zum allgemeinwissenschaftlichen Angebot entnehmen Sie dem AW-Katalog auf der Webseite der OTH Regensburg. Im Rahmen des allgemeinwissenschaftlichen Angebots ist es möglich, durch Belegung einer ganzen Fächergruppe bestimmte zertifizierte Qualifikationen zu erwerben.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 1 (General Scientific Elective Module 1)		AW1
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Gabriele Blod	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Lehrende im AW-Programm (LB)	in jedem Semester	
Lehrform		
Je nach Lehrveranstaltung		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. oder 2.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Klausur oder Studienarbeit und/oder mündlicher Leistungsnachweis. (Der Katalog mit Wahlpflichtmodulen wird im Studienplan für die Allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule festgelegt. Dieser regelt auch die zu erbringenden Prüfungsleistungen.)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Je nach Lehrveranstaltung

Inhalte
Je nach Lehrveranstaltung
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Je nach Lehrveranstaltung
Angebotene Lehrunterlagen
Je nach Lehrveranstaltung
Lehrmedien
Je nach Lehrveranstaltung
Literatur
Je nach Lehrveranstaltung

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 2 (General Scientific Elective Module 2)		AW2
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Gabriele Blod	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Lehrende im AW-Programm (LB)	in jedem Semester	
Lehrform		
Je nach Lehrveranstaltung		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. oder 2.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Klausur oder Studienarbeit und/oder mündlicher Leistungsnachweis. (Der Katalog mit Wahlpflichtmodulen wird im Studienplan für die Allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule festgelegt. Dieser regelt auch die zu erbringenden Prüfungsleistungen.)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Je nach Lehrveranstaltung

Inhalte
Je nach Lehrveranstaltung
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Je nach Lehrveranstaltung
Angebotene Lehrunterlagen
Je nach Lehrveranstaltung
Lehrmedien
Je nach Lehrveranstaltung
Literatur
Je nach Lehrveranstaltung

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Allgemeinwissenschaftliches Wahlpflichtmodul 3 (General Scientific Elective Module 3)		AW3
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Gabriele Blod	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Lehrende im AW-Programm (LB)	in jedem Semester	
Lehrform		
Je nach Lehrveranstaltung		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. oder 2.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Klausur oder Studienarbeit und/oder mündlicher Leistungsnachweis. (Der Katalog mit Wahlpflichtmodulen wird im Studienplan für die Allgemeinwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule festgelegt. Dieser regelt auch die zu erbringenden Prüfungsleistungen.)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Je nach Lehrveranstaltung

Inhalte
Je nach Lehrveranstaltung
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Je nach Lehrveranstaltung
Angebotene Lehrunterlagen
Je nach Lehrveranstaltung
Lehrmedien
Je nach Lehrveranstaltung
Literatur
Je nach Lehrveranstaltung

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Elektronische Bauelemente (Electronic Circuit Elements)		EB / Nr.8
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Oliver Steffens	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
2.	1.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Mathematik 1 (Modul Nr.3), Technische Physik 1 (Modul Nr.4)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Elektronische Bauelemente (Electronic Circuit Elements)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Elektronische Bauelemente (Electronic Circuit Elements)		EB
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Oliver Steffens	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Oliver Steffens	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
2.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
1. Einleitung – Physikalische Grundlagen, Symbole, lineare Netzwerke 2. Passive Bauelemente: Widerstand, Kondensator, Spule / Transformator 3. Halbleiter-Bauelemente – Grundlagen (Bändermodell, Kontakte/pn-Übergang) Physikalische Funktionsweisen, statisches Verhalten, dynamisches Verhalten, Simulationsmodelle exemplarische Anwendungen für: 4. Dioden 5. Bipolar-Transistor (Ebers-Moll-Modell) 6. MOS-Kapazität und Feldeffekttransistor
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> Die Studierenden kennen verschiedene Typen und Bauformen von passiven Bauelementen und deren Eigenschaften hinsichtlich Physik und Material. Sie kennen die Möglichkeiten der Planartechnologie zur Herstellung von aktiven elektronischen Bauelementen, insbesondere aktiven Bauelementen aus dotierten Halbleitern und deren physikalische Eigenschaften.
Fertigkeiten:

- Die Studierenden können einfache elektrische Schaltkreise verstehen und durch Nutzung von Knoten- und Maschenregel vereinfachen, und sie können Ersatzspannungsquellen von linearen Netzen berechnen.
- Im Bereich der Halbleiter-Bauelemente können sie Bänderdiagramme zeichnen, auch für Kontaktstellen (pn-Übergang) und das Verhalten bei angelegtem elektrischen Feld in Durchlass- und Sperrrichtung damit beschreiben.
- Für Bipolar-Bauelemente können Sie durch Anwendung des Ebers-Moll-Modells ein vereinfachtes Ersatzschaltbild zeichnen und berechnen.

Kompetenzen:

- Die Studierenden können verschiedene gängige Bauelemente gezielt für bestimmte schaltungstechnische Aufgaben auswählen und deren Funktion und Einsatzbereiche beurteilen. Auf dieser Basis sind sie in der Lage, sich später komplexere (zunächst analoge) Schaltungsanwendungen zu erschließen.

Angebotene Lehrunterlagen

Vorlesungsskript mit Übungen, Moodle-Kursraum

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Tietze, U., Schenk, Ch.: Halbleiter-Schaltungstechnik. 14., überarb. und erw. Aufl., Springer, Berlin/New York (2012)
- Reisch, M.: Halbleiter-Bauelemente. Springer, Berlin/New York (2005)
- Thuselt, Frank: Physik der Halbleiterbauelemente. Einführendes Lehrbuch für Ingenieure und Physiker. 2. Aufl., Springer, Berlin (2011)
- Nicollian, E. H., Brews, J. R.: MOS (Metal Oxide Semiconductor) Physics and Technology. Wiley, New York (1982)
- Warner, R. M., Grung, B. L.: Semiconductor-device electronics. International edition. Holt, Rinehart and Winston, Philadelphia (1991)
- Müller, R.: Bauelemente der Halbleiter-Elektronik (Halbleiter-Elektronik, Bd. 2). 4., überarb. Aufl., Springer, Berlin/New York (1991)

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Nach Möglichkeit wird ein begleitendes Tutorium angeboten.

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Informationsverarbeitung mit Praktikum (Information Processing with Laboratory Exercises)		IVP / Nr.1
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Rudolf Bierl	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	1.	Pflicht	7

Verpflichtende Voraussetzungen
Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung im Teilmodul <i>Informationsverarbeitung</i> (Modul Nr. 1.1 / IV): bestandenes <i>Praktikum Informationsverarbeitung</i> (Modul Nr. 1.2 / PIV)
Empfohlene Vorkenntnisse
Keine

Inhalte
Siehe Folgeseiten
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseiten

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Informationsverarbeitung (Information Processing)	4 SWS	3
2.	Praktikum Informationverarbeitung (Laboratory Exercises: Information Processing)	4 SWS	4

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Informationsverarbeitung (Information Processing)		IV
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Rudolf Bierl	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Rudolf Bierl	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	4 SWS	deutsch	3

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Zulassungsvoraussetzung: bestandenes <i>Praktikum Informationsverarbeitung</i> (Modul Nr 1.2 / PIV)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

LABVIEW:

- Geschichte der Informatik
- Duales Zahlensystem
- Kennenlernen von strukturierter Programmierung
- Bedienung von LabVIEW
- Erstellen Ihrer ersten Anwendung
- Suchen und Beheben von Fehlern in VIs
- Verwenden von Schleifen
- Erstellen und Verwenden von Datenstrukturen
- Erzeugen von Programm-verzweigungen mittels Strukturen
- Modularität
- Durchführen von Messungen mit Hilfe von Hardware
- Arbeiten mit Dateien in LabVIEW
- Verwenden von sequenziellen Algorithmen und Zustandsautomaten

MATLAB:

- Hintergründe und Daten zu Mathworks Matlab
- Allgemeine Grundlagen zu Matrizenoperationen
- Mathematische Probleme mit Matrizen lösen
- Aufbau und Bedienung der Benutzeroberfläche in Matlab
- Eingeben von Daten in Matrizenform und deren Weiterverarbeitung
- M-Files; Skripte erstellen und anwenden; Anonyme Funktionen in Matlab
- Speichern und Laden von Messdaten
- Grafische Ausgaben von Punkten bzw. Linien in 2D und komplexen Datenstrukturen in 3D
- Speichern, Laden und manipulieren von Bilddateien und Graphiken
- Interpolieren und Approximieren von Messdaten
- Elementare Optimierung in Matlab
- Signalverarbeitung in Matlab; Fast Fourier-Transformation in Matlab
- Laufzeitgeschwindigkeitstests von Matlab Funktionen und Programmen

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

LABVIEW:

Kenntnisse:

- Erlernen theoretischer Grundlagen
- Grundlagen der Programmierung
- Kennenlernen und Anwenden einer grafischen Programmiersprache (Labview)

Fertigkeiten:

- Fertigkeit, Algorithmen und Datenstrukturen eigenständig zu programmieren
- Fertigkeit, Fehleranalyse von Programmen durchzuführen
- Fertigkeit, den Ablauf komplexer Programme zu verstehen und zu analysieren
- Fertigkeit, grafische Bedienoberflächen intuitiv bedienbar zu gestalten

Kompetenzen aus Unterricht und Praktikum:

- Analyse von technischen Aufgabenstellungen im Hinblick auf die Umsetzung mit Labview

- Umsetzung gegebener technischer Aufgabenstellungen mit LABVIEW unter Beachtung von technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen

MATLAB

Kenntnisse:

- Erlernen theoretischer Grundlagen zu Matrizen und deren Operationen
- Matlab Benutzeroberfläche bedienen
- Grundlagen zur Matlab Programmierung
- Plotten in 2D und 3D in Matlab
- Bildbearbeitung in Matlab
- Interpolation und Approximation

Fertigkeiten:

- Fertigkeit, Matrizen zu erstellen und zu bearbeiten
- Fertigkeit, Fehleranalyse von Matlab Programmen durchzuführen
- Fertigkeit, den Ablauf prozeduraler Programme zu verstehen und zu analysieren
- Fertigkeit, Messdaten sinnvoll grafisch auszugeben
- Fertigkeit, Messdaten zu bearbeiten, zu interpretieren und abzuspeichern

Kompetenzen Unterricht und Praktikum:

- Analyse von technischen Aufgabenstellungen im Hinblick auf die Umsetzung mit Matlab
- Umsetzung gegebener technischer und mathematischer Aufgabenstellungen mit Matlab unter Beachtung von technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

LABVIEW:

- Handbuch für die Programmierung mit LabVIEW von Bernward Mütterlein; ISBN 978-3-8274-1761-9
- Einführung in Labview von Wolfgang Georgi, Hanser Verlag, ISBN 978-3-446-41560-7
- R. Jamal / A. Hagedstedt: Labview - Das Grundlagenbuch, Addison-Wesley, August 2004
- Peter A. Blume: The Labview Style Book, Prentice Hall, 2004

MATLAB:

- Physical Modeling in MATLAB; von Allen Downey kostenlos unter [http:// greenteapress.com/matlab](http://greenteapress.com/matlab)
- Programmieren mit MATLAB; von Ulrich Stein als eBook über die Bibliothek
- MATLAB 7 für Ingenieure; von Frieder Grupp und Florian Grupp als eBook über die Bibliothek

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Praktikum Informationsverarbeitung (Laboratory Exercises: Information Processing)		PIV
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Rudolf Bierl	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Matthias Altmann (LB) Prof. Dr. Rudolf Bierl Johannes Fischer (LB)	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Praktikum		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	4 SWS	deutsch	4

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	60h

Studien- und Prüfungsleistung
Praktischer Leistungsnachweis (m.E.) in Labview und Matlab: Labview: Projektarbeit in der Gruppe und Projektpräsentation im Umfang von 15- 20 Min. Matlab: Abgabe von mind. 80% der angebotenen Übungsblätter.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

LABVIEW:

- Programmierung des Lego Roboters mit Hilfe der grafischen Programmiersprache Labview.
- Kennenlernen eines Embedded Systems.
- Projektarbeit im Team: Steuerung des Lego Roboters durch einen Parcours; Lösen vieler programmiertechnischer Aufgaben; Erlernen von strukturierter Softwareentwicklung.
- Spielerisches Kennenlernen der Grundbegriffe der Sensorik: Kalibrierung, etc.

MATLAB:

- Aufgaben zu grundlegenden Matrizenoperationen
- Aufgaben zu mathematischen Problemen mit Matrizen lösen
- Erlernen und Bedienung der Benutzeroberfläche in Matlab
- Eingeben von Daten in Matrizenform und deren Weiterverarbeitung
- Aufgaben zu M-Files; Skripte erstellen und anwenden; Anonyme Funktionen in Matlab
- Aufgaben zum Speichern und Laden von Messdaten
- Aufgaben zur grafische Ausgabe von Punkten bzw. Linien in 2D und komplexen Datenstrukturen in 3D.
- Aufgaben zum Speichern, Laden und manipulieren von Bilddateien und Graphiken
- Aufgaben zum Interpolieren und Approximieren von Messdaten.
- Aufgaben zur elementaren Optimierung in Matlab.
- Aufgaben zu Signalverarbeitung in Matlab; Fast Fourier-Transformation in Matlab
Laufzeitgeschwindigkeitstests von Matlab Funktionen und Programmen.

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

LABVIEW:

Kenntnisse:

- Kennenlernen und Anwenden einer grafischen Programmiersprache (Labview)
- Praktisches Umsetzen theoretischer Grundlagen
- Grundlagen der Programmierung eines Embedded Systems
- Kennenlernen unterschiedlicher Sensorprinzipien und deren Kalibriermethoden

Fertigkeiten:

- Fertigkeit, Algorithmen und Datenstrukturen eigenständig programmieren
- Fertigkeit, Fehleranalyse von Programmen durchzuführen
- Fertigkeit, den Ablauf komplexer Programme zu verstehen und zu analysieren
- Fertigkeit, grafische Bedienoberflächen intuitiv bedienbar zu gestalten

Kompetenzen:

- Soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit und Arbeitsteilung
- Methodische Kompetenzen wie Problemanalyse, Systematik und Lösungsfindung werden erweitert
- Rhetorische Kompetenzen zur Kommunikation und Präsentation von Konzepten und Ergebnissen werden verbessert
- Projektmanagement
- Reflexion der eigenen Leistung
- Kreativität

- Zeitmanagement

MATLAB:

Kenntnisse:

- Erstellen von Matrizen und deren Operationen
- Matlab Benutzeroberfläche bedienen
- Grundlagen zur Matlab Programmierung
- Plotten in 2D und 3D in Matlab
- Bildbearbeitung in Matlab
- Interpolation und Approximation

Fertigkeiten:

- Fertigkeit, Matrizen zu erstellen und zu bearbeiten
- Fertigkeit, Fehleranalyse von Matlab Programmen durchzuführen
- Fertigkeit, den Ablauf prozeduraler Programme zu verstehen und zu analysieren
- Fertigkeit, Messdaten sinnvoll grafisch auszugeben
- Fertigkeit, Messdaten zu bearbeiten, zu interpretieren und abzuspeichern

Kompetenzen:

- Analyse von technischen Aufgabenstellungen im Hinblick auf die Umsetzung mit Matlab
- Umsetzung gegebener technischer und mathematischer Aufgabenstellungen mit Matlab unter Beachtung von technischen und wirtschaftlichen Randbedingungen

Angebotene Lehrunterlagen

Übungsblätter

Literatur

LABVIEW:

- Labview for Lego Mindstorms NXT von Michael Gasperi

MATLAB:

- Physical Modeling in MATLAB; von Allen Downey kostenlos unter <http://greenteapress.com/matlab>
- Programmieren mit MATLAB; von Ulrich Stein als eBook über die Bibliothek
- MATLAB 7 für Ingenieure; von Frieder Grupp und Florian Grupp als eBook über die Bibliothek

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Aufteilung: 2 SWS LabVIEW und 2 SWS Matlab

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Mathematik 1 (Mathematics 1)		MA1 / Nr. 3
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Oliver Stein	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	1.	Pflicht	8

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Keine

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Mathematik 1 (Mathematics 1)	8 SWS	8

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Mathematik 1 (Mathematics 1)		MA 1	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Oliver Stein		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Oliver Stein		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	8 SWS	deutsch	8

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
120h	120h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Vektorrechnung und Analytische Geometrie:

- Rechenoperationen mit Vektoren, Betrag, Skalarprodukt, Vektorprodukt, Spatprodukt, orthogonale Projektion, Geraden und Ebenen
- Anwendungen in Geometrie, Physik und Technik

Differentialrechnung:

- Ableitung von differenzierbaren Funktionen und von Kurven in Parameterdarstellung

Anwendungen der Differentialrechnung:

- z. B. Kurvendiskussion, Extremwerte, Newton-Verfahren

Integralrechnung:

- Bestimmtes und unbestimmtes Integral, Integrationsregeln, Numerische Integration, Uneigentliche Integrale
- Längen- Flächen- und Volumenmessung
- Anwendungen der Integralrechnung z. B. in der Kinematik, Schwerpunkte, Momente

Unendliche Reihen:

- Zahlenreihen und Funktionenreihen, Konvergenzkriterien, Fehlerabschätzung
- Potenzreihen und Taylor-Reihen;
- Anwendungen: z.B. Approximation, Integration durch Reihenentwicklung
- Fourier-Reihen, Numerische Fourieranalyse, Interpretation in der Technik

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Kenntnis grundlegender Begriffe der linearen Algebra, insbesondere der Vektorrechnung, sowie deren Anwendung in Physik und Technik: z. B Vektoren, Euklidische Skalarprodukt, Euklidischer Betrag, Vektorprodukt usw.
- Kenntnis grundlegender Begriffe der eindimensionalen reellen Analysis: z.B. Folge, Grenzwert, Ableitung und Integral sowie deren Bedeutung in der Physik und Technik.
- Übersicht über wesentliche Regeln und Methoden der linearen Algebra: z.B. Rechenregeln für Vektoren, Rechengesetze für das Euklidische Skalarprodukt und den Euklidischen Betrag usw.
- Übersicht über wesentliche Regeln und Methoden der eindimensionalen reellen Analysis: z.B. Differentiationsregeln, Integrationsmethoden, Grenzwertregeln

Fertigkeiten:

- Sichere Anwendung von der Rechenregeln von Vektoroperationen.
- Anwendung der Vektorrechnung in Anwendungsbeispielen aus Physik und Technik.
- Korrekte Anwendung wesentlicher Konvergenzkriterien bei Folgen und Reihen.
- Beherrschung der Differentiationsregeln einer Veränderlichen.
- Korrekte Anwendung wesentlicher Integrationsmethoden einer Veränderlichen.

Kompetenzen:

- Sichere Konvergenzanalyse bei Folgen und Reihen.
- Einsatz der Differentialrechnung zur Diskussion des Verhaltens einer Funktion in einer reellen Veränderlichen.
- Einsatz der Differentialrechnung zur Lösung von Extremwertaufgaben und zur Approximation von Funktionen.
- Nutzung der Integralrechnung zur Berechnung geometrischer und physikalisch technischer Größen.
- Übersetzung praktischer Fragestellungen in mathematische Probleme.

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Bronstein I., Semendjajew K., Taschenbuch der Mathematik, Verlag Harri Deutsch
- Erven J., Erven M., Hörwick J., Vorkurs Mathematik, Oldenbourg Wissenschaftsverlag
- Erven J., Schwägerl D., Mathematik für Ingenieure, Oldenbourg Wissenschaftsverlag
- Erven J., Schwägerl D., Übungsbuch zur Mathematik für Ingenieure, Oldenbourg Wissenschaftsverlag
- Leitz M., Ingenieurmathematik 1 (Kurzsskript), Hochschule Regensburg
- Meyberg K., Vachenaer P., Höhere Mathematik 1, Springer Verlag
- Papula L., Mathematische Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Vieweg Verlag

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Mathematik 2 (Mathematics 2)		MA 2 / Nr.7
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Oliver Stein	Informatik und Mathematik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
2.	1.	Pflicht	7

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Mathematik 1 (Modul Nr. 3)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Mathematik 2 (Mathematics 2)	8 SWS	7

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Mathematik 2 (Mathematics 2)		MA2	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Oliver Stein		Informatik und Mathematik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Oliver Stein		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
2.	8 SWS	deutsch	7

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
120h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Fourier-Reihen:

Periodische Funktion, harmonische Grundschiwingung, Begriff der Fourier-Reihe, stückweise stetig-differenzierbare Funktionen, punktweise Konvergenz von Fourier-Reihen, Anwendung von Fourier-Reihen zur Approximation periodischer Funktionen.

Komplexe Zahlen:

Der Körper der komplexen Zahlen, Kartesische Darstellung, Exponentialdarstellung, komplexe Exponentialfunktion, Zerlegung von Polynomen; Anwendungen in der Wechselstromtechnik: Komplexe Darstellung von Schwingungen, Wechselstromnetzwerke, komplexe Widerstände.

Differentialrechnung für Funktionen mehrerer reeller Veränderlicher

Funktionen mehrerer reeller Veränderlicher, Niveaukurven, partielle Ableitungen, Richtungsableitung, vollständige Differenzierbarkeit, Gradient, Tangentialebene. Anwendungen der Differentiation: z. B. Bedeutung des Gradienten, Fehlerrechnung, lokale Extremwerte, Extremwerte unter Nebenbedingungen, globale Extremwerte.

Gewöhnliche Differentialgleichungen:

Differentialgleichungen erster Ordnung: Lineare Differentialgleichungen, Differentialgleichungen mit getrennten Veränderlichen, klassische Numerische Verfahren [Polygonzugverfahren, Runge-Kutta-Verfahren].

Differentialgleichungen zweiter Ordnung: Lineare Differentialgleichungen zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten, spezielle nichtlineare Differentialgleichungen 2. Ordnung, klassische Numerische Verfahren.

Lineare Differentialgleichungssysteme: Lineare Differentialgleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten.

Anwendungen von Differentialgleichungen: z.B. mechanische oder elektrische Schwingungen bzw. Schwingungssysteme.

Die Laplace-Transformation:

Begriff der Laplace-Transformation, Rechenregeln der Laplace-Transformation, Umkehrtransformation der Laplace-Transformation; Anwendung auf lineare Differentialgleichungen und lineare Differentialgleichungssysteme mit konstanten Koeffizienten. Anwendungen in der Systemtheorie: LTI-Systeme, Übertragungsfunktion, Gewichtsfunktion, Impulsantwort, Sprungantwort, Stabilität, Frequenzgang

Lineare Algebra:

Matrizen, Lineare Gleichungssysteme, Anwendungen der linearen Algebra: z.B. elektrische Netzwerke

Optional: Determinanten, Eigenwerte, Eigenräume und Anwendungen dazu: z.B.

Eigenfrequenzen eines Systems gekoppelter Oszillatoren.

Integralrechnung für Funktionen mehrerer reeller Veränderlicher Kurvenintegrale (optional!):

Vektorfelder, Potentialfelder, Kurvenintegral eines Vektorfeldes, Wegunabhängigkeit, Kurvenintegral eines Skalarfeldes.

Integration über ebene Bereiche: Integration über Normalbereiche, Transformationen (z.B. auf Polarkoordinaten).

Anwendungen: z.B. Arbeit, Momente, Schwerpunkte, Volumenberechnungen.

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Kenntnisse grundlegender Begriffe im Zusammenhang mit Fourier-Reihen sowie deren Anwendung bei der Approximation periodischer Funktionen.
- Kenntnis des Begriffs der komplexen Zahl sowie deren unterschiedliche Darstellungsform.
- Kenntnis des Begriffs der gewöhnlichen Differentialgleichung und deren Anwendung zur Beschreibung und Lösung technisch-physikalischer Probleme.
- Übersicht über die wesentlichen Begriffe der mehrdimensionalen reellen Analysis: z. B. partielle Ableitung, Richtungsableitung, Gradient, partielle Differentialgleichung usw.
- Kenntnis des Konzeptes der Laplace-Transformation, insbesondere als Hilfsmittel zur Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen.
- Kenntnis des Begriffs der Matrix und des linearen Gleichungssystems sowie deren Anwendung in der Technik.

Fertigkeiten:

- Berechnung der Fourier-Reihe einer periodischen Funktion, Bestimmung der Konvergenzeigenschaften einer Fourier-Reihe.
- Sicheres Rechnen mit komplexen Zahlen und elementaren komplexen Funktionen.
- Erkennen des Typs einer gewöhnlichen Differentialgleichung, Einsatz des geeigneten Verfahrens zur Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung.
- Sichere Berechnung partieller Ableitungen, Bestimmen von lokalen und globalen Extrema von Funktionen mehrerer Veränderlicher.
- Berechnung der Laplace-Transformierten, sichere Beherrschung Transformationsregeln für die Laplace-Transformation.
- Beherrschung der Matrizenrechnung, Beherrschung von grundlegenden Verfahren zur Lösung von linearen Gleichungssystemen.

Kompetenzen:

- Approximation periodischer Funktionen aus technischen Anwendungen mit Hilfe von Fourier-Reihen.
- Sicherer Umgang mit komplexen Zahlen und elementaren komplexen Funktionen im Hinblick auf Anwendungen in der komplexen Wechselstromtechnik.
- Lösen einer physikalisch-technischen Problemstellung durch die Analyse des Lösungsraumes einer geeigneten gewöhnlichen Differentialgleichung.
- Lösen einer physikalisch-technischen Problemstellung durch den Einsatz der Differentialrechnung zur Bestimmung des Verhaltens einer Funktion in mehreren Veränderlichen (z. B. Bestimmung von Extremwerten).
- Lösung von linearen Differentialgleichungen mit Hilfe der Laplace-Transformation.
- Sichere Analyse des Lösungsraumes eines linearen Gleichungssystems.

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Bronstein I., Semendjajew K., Taschenbuch der Mathematik, Verlag Harri Deutsch
- Erven J., Schwägerl D., Mathematik für Ingenieure, Oldenbourg Wissenschaftsverlag
- Erven J., Schwägerl D., Übungsbuch zur Mathematik für Ingenieure, Oldenbourg Wissenschaftsverlag
- Leitz M. Ingenieurmathematik 2 (Kurzsskript), Hochschule Regensburg
- Meyberg K., Vachenauer P., Höhere Mathematik 1, Springer Verlag
- Meyberg K., Vachenauer P., Höhere Mathematik 2, Springer Verlag
- Papula L., Mathematische Formelsammlung für Ingenieure und Naturwissenschaftler, Vieweg Verlag
- Weber H., Ulrich H., Laplace-Transformation, Grundlagen – Fourierreihen und Fourierintegral – Anwendungen, Teubner Verlag

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Technische Physik 1 (Engineering Physics 1)		TP1 / Nr.4
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Peter Bickel Prof. Dr. Ernst Wild	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. und 2.	1.	Pflicht	8

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Keine

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Technische Physik 1 (Engineering Physics 1)	8 SWS	8

Hinweise zur Belegungspflicht oder zu Optionen
Das Modul erstreckt sich über zwei Semester: Teil 1 (WiSe) / Teil 2 (SoSe)

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Technische Physik 1 (Engineering Physics 1)		TP 1	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Peter Bickel Prof. Dr. Ernst Wild		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Peter Bickel Prof. Dr. Ernst Wild		jährlich	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. und 2.	8 SWS	deutsch	8

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
120h	120h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Teil 1 (WiSe):

Mechanik

- Physikalische Erkenntnisgewinnung
- Der Messprozess: Systematische Fehler – Statistische Fehler
- Kinematik der Massepunkte
- Dynamik der Bewegung: Die Newton'schen Axiome ,Lösung von Bewegungsgleichungen
- Arbeit, Energie und Leistung- Kraftfelder, Potential und Potentialfelder am Bsp. der Gravitation, Wie hängen Feld und Potential zusammen?, Abstandsgesetz der Kraft und Geometriemomentensatz für Systeme von MP
- Erhaltungsgrößen der Drehbewegung, Drehmoment und Drehimpuls, Massenträgheitsmoment, Corioliskraft
- Mechanik deformierbarer Körper, Elastische Verformungen, Mechanik der Flüssigkeiten und Gase, Hydrostatik
- Grenzflächeneffekte, Oberflächenspannung- Fluiddynamik, Hydrodynamik, Bernoulli Gleichung, Reibungskräfte in strömenden Flüssigkeiten, Laminare und turbulente Strömungen, Ähnlichkeit, Reynoldszahl

Teil 2 (im SoSe):

Elektrostatik

- Ladungen, Coulombkraft
- Elektrisches Feld
- Fluß des elektrischen Feldes
- Gauß'scher Satz
- Elektrisches Potential
- Kapazitäten
- Materie im elektrischen Feld

Elektrodynamik

- Freie Elektronen im elektrischen Feld
- Ströme
- Ohm'sches Gesetz
- Magnetfelder, Lorentzkraft, Hall Effekt
- Fluß des Magnetfeldes
- Durchflutungsgesetz
- Induktivitäten
- Magnetfelder in Materie

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Die Studierenden kennen die grundlegenden Konzepte und Methoden der Physik.
- Die Studierenden kennen die in der Mechanik elementaren Begriffe der Kinematik, das Konzept der Kraft und des Impulses und darauf aufbauend Arbeit, Energie, der physikalische Feldbegriff sowie das Potenzial.
- Die Studierenden verfügen über das für die weiteren Physik- und Technikvorlesungen erforderliche Basiswissen.

Fertigkeiten:

- Sie können grundlegende mathematische Methoden anwenden und verfügen über vertieftes Wissen darin.
- Ferner haben sie den Umgang mit physikalischen Erhaltungsgrößen in Theorie und Praxis erlernt und können Konzepte auf reale Körper und Fluide anwenden.

Kompetenzen:

- Sie sind in der Lage physikalische Zusammenhänge zu erkennen, technische Probleme zu analysieren und mit physikalischen Methoden zu lösen.

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Friedhelm Kuypers: Physik für Ingenieure Band 1: Mechanik und Thermodynamik, VCH Verlagsgesellschaft mbH, D-69451 Weinheim
- Hering-Martin-Stohrer: Physik für Ingenieure, VDI-Verlag, Düsseldorf
- Bohrmann-Pitka-Stöcker/Terleck: Physik für Ingenieure, Verlag Harry Deutsch, Frankfurt/Main
- Hans J. Paus: Physik, Hanser Verlag, München
- Gehrtzen, Kneser, Vogel, „Physik“, Springer Verlag
- David Halliday, Robert Resnick: Fundamentals of Physics, Verlag Wiley & Sons, New York
- Hummel, Kempf, Kuypers, Wild: Elektrik, Wellen, Atom- und Kernphysik, Physik für Ingenieure Band 2, VCH Verlagsgesellschaft mbH, Weinheim
- Edward M. Purcell: Electricity and Magnetism, Mc. Graw Hill Verlag, New York
- Klaus Dransfeld, Paul Kienle: Physik II, Oldenbourg Verlag, München
- Dobrinsky, Krakau, Vogel, „Physik für Ingenieure“, Teubner ISBN 3-519-16501-5

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Ein begleitendes Tutorium zu Teil 1 und 2 wird jeweils im Sommersemester angeboten.

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Technisches Englisch (Technical English)		TE / Nr.5
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Ulrich Martzinek (LB)	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. und 2.	1.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Keine

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Technisches Englisch (Technical English)	4 SWS	4

Hinweise zur Belegungspflicht oder zu Optionen
Das Modul erstreckt sich über 2 Semester.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Technisches Englisch (Technical English)		TE
Verantwortliche/r	Fakultät	
Ulrich Martzinek (LB)	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Ulrich Martzinek (LB)	jährlich	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht mit Übungen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1. und 2.	4 SWS	deutsch/englisch	4

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	60h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Prüfung bestehend aus: Diktat, Übersetzung und Fragen zum Wissensstoff des Unterrichts.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Keine

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Grundlegende Strukturzüge und Merkmale des Englischen als Fachsprache • Verbreitete Strukturen komplexer Syntax • Behandlung gängiger Phrasen • Probleme und Besonderheiten der Wortbildung im Englischen als Fachsprache • Englisch-deutsche Besonderheiten der Grammatik • Wichtige Unterschiede in den Interpunktionssystemen des Englischen und Deutschen • Wesen und Problematik der Metaphorik in der Fachsprache • Relevante fremdsprachliche Einflüsse im Englischen als Fachsprache • Wesen und Problematik von Abkürzungen • Grundlagen der Zahlensysteme, Geometrie, numerischen und abstrakten Darstellungen in angewandter Mathematik • Grundlagen in Englisch aus Chemie, Physik und Elektrotechnik/Elektronik • Sozio-kulturelle Unterschiede und ihre Berücksichtigung im englisch-deutschen Begriffssystem • Fachlich verschriftete Darstellungen von einem repräsentativen naturwissenschaftlichen Spektrum an Themen aus Mikrosystemtechnik (MS) sowie Sensorik & Analytik (SA)

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Reaktivierung der Funktionsfähigkeit von Schulenglisch.• Zugrundelegung und Ausbau eines englischen Fachwortschatzes.• Problematisierung der anglizistischen Durchdringung des Deutschen sowie der MST-Fachsprache. <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Entwicklung der Fähigkeit, englische Fachtexte aus der Mikrosystemtechnik und angrenzender Wissenschaften zu lesen und durch Übersetzung ins Deutsche nachweislich zu erfassen sowie mündliche Darstellungen in einem englischen Fachvortrag zu verstehen.• Erfassung von wichtigen englischsprachigen Grundlagen in MS, SA, Chemie, Physik, Mathematik und entsprechend angewandten Technologien.• Hinführung zum Verständnis von naturwissenschaftlichen Themen aus MS sowie SA in technisch-technologischem Englisch <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beherrschung eines Grundstocks an lexikalischen, phraseologischen sowie syntaktischen Strukturen im für MS & SA relevantem technologischem Englisch.• Selbstverantwortliche Durchdringung von fachlichen Darstellungen auf Englisch in Büchern, Aufsätzen und Vorträgen.
Angebotene Lehrunterlagen
Authentische Fachliteratur in Englisch zur Erarbeitung der diversen sprachlichen Fachproblematiken (vom Modulverantwortlichen)
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Fachzeitschrift Compoundsemiconductor (elektronisch) als ein exemplarisches Arbeitsmittel• Wörterbücher Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch aus dem gehobenen Sekundarschulbereich• Fremdwörterbuch Deutsch und/oder Englisch

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Werkstoffe 1 (Materials Sciences 1)		WE1 / Nr.6
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Zuordnung zu weiteren Studiengängen
Sensorik und Analytik

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
2.	1.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Allgemeine und Anorganische Chemie mit Praktikum (Modul Nr. 2)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Werkstoffe 1 (Materials Sciences 1)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Werkstoffe 1 (Materials Sciences 1)		WE1	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Alfred Lechner		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
2.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Chemikalien in der Halbleitertechnologie:

- * Wasserstoffperoxid
- * Chlorwasserstoff
- * Ammoniak
- * Cholin
- * Schwefelsäure
- * Fluorwasserstoff
- * Ammoniumfluorid
- * Verschiedene Lösungsmittel

Metallische Werkstoffe:

- * Legierungen
- * Mischkristalle
- * Gibbsche Phasenregel
- * Phasendiagramm des Eutektikums ohne Mischkristallbildung
- * Phasendiagramm für vollständige Löslichkeit im flüssigen und festem Zustand
- * Phasendiagramm mit Mischkristallbildung
- * Phasendiagramm des Peritektikums
- * Beispiele: Blei-Zinn, Eisen-Kohlenstoff, Kupfer-Legierungen, Aluminium-Legierungen

Halbleiter:

- * Energiebändermodell
- * Darstellung von Reinstsilicium
- * Einkristallzucht aus der Schmelze
- * Impfkristall, Millersche Indizes
- * Waferherstellung, Reinigungen
- * III/V - Halbleiter
- * Anwendungen

Kunststoffe:

- * Arten der Kunststoffe
- * Thermoplaste
- * Duroplaste
- * Herstellungsverfahren und Reaktionsmechanismen
- * Eigenschaften der Kunststoffe
- * Bearbeitungsverfahren

Werkstoffprüfungen:

- * Kunststoffe
- * Metalle

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Kenntnis der Stoffe, die in der Mikrotechnik sowie der Sensorik und Analytik zur Anwendung kommen (wird weitergeführt in den Modulen Werkstoffe 2 bzw. Organische Chemie und Funktionelle Werkstoffe).
- Detaillierte Kenntnis der wichtigsten nasschemischen Chemikalien, die in der Halbleiter-Technologie Anwendung finden, hinsichtlich ihrer Herstellungsverfahren, ihrer

Eigenschaften, ihrer typischen chemischen Reaktionen und ihrer Aufgaben in der Mikrosystemtechnik und Analytik.

- Kenntnisse über die metallischen Leiterwerkstoffe, deren Legierungen, die verschiedenen Halbleiterwerkstoffe und Kunststoffe.

Fertigkeiten:

- Fertigkeit zum Lesen von Phasendiagrammen

Kompetenzen:

- Kompetenz zur Anwendung von Werkstoffen in der Halbleitertechnik
- Kompetenz zur Anwendung geeigneter Chemikalien für Ätz- und Reinigungsprozesse
- Kompetenz zur Anwendung geeigneter Legierungen in der Verbindungstechnik

Angebotene Lehrunterlagen

Skript Werkstoffe 1, Alfred Lechner, OTH Regensburg

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- U. Hilleringmann, Silizium-Halbleitertechnologie, Teubner Verlag, Stuttgart, 2002
- Bargel/Schulze Werkstoffkunde VDI Verlag
- E. Ivers-Tiffée, W. von Münch, Werkstoffe der Elektrotechnik, Teubner Verlag, Stuttgart, 2004

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Berufsvorbereitendes Praktikum (Vocational Preparation Internship)		BP/ Nr.22
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Manfred Hopfenmüller	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
5.	2	Pflicht	25

Verpflichtende Voraussetzungen
Alle 60 ECTS aus dem ersten Studienabschnitt, weitere 30 ECTS aus dem 2. Studienabschnitt.
Empfohlene Vorkenntnisse
Theoretische Kenntnisse aus 4 Studiensemestern.

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Praktikum (Internship)		23
2.	Praxisseminar (Seminar of Practical Course)	2 SWS	2

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Praktikum (Internship)		PX	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Manfred Hopfenmüller		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
N.N.		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Praktikum (18 Wochen extern)			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
5.		deutsch	23

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
	690h

Studien- und Prüfungsleistung

Das Praktikum ist wie folgt zu dokumentieren:

- Praktikantenvertrag (Abgabe spätestens zwei Wochen vor Praktikumsbeginn)
- Erstellung eines Praktikumsberichts (4000 bis 6000 Zeichen) (m.E.)
- Die Abgabe des Praktikumsberichts erfolgt nach Beendigung des Praktikums (im Servicebüro). Alle Berichte müssen mit Stempel und Unterschrift der Ausbildungsfirma versehen sein. Der Praktikant/Die Praktikantin hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass die Rahmenbedingungen (Ausbildungsziel, Inhalt, Formalien) des Praktikums eingehalten werden.
- Der Bericht sollte zu mindestens 2/3 aus der Dokumentation der eigenen Arbeit bestehen (Arbeitsaufgaben und Vorgehensweise) und konkrete Ergebnisse darstellen.
- Sollten die Rahmenbedingungen nicht eingehalten werden können, so ist rechtzeitig Rücksprache mit dem Ausbildungsbeauftragten in der Ausbildungsstelle zu nehmen.
- Das Praktikumszeugnis wird nach Beendigung des Praktikums im Original im Servicebüro vorgelegt (Kopie mitbringen).

Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis

Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Projektbezogene Arbeit an einem mikrotechnologischen Prozess oder Mikrosystem auf einem Niveau, das den bisher im Studium erworbenen Fähigkeiten entspricht, an einem frei wählbaren, mit der externen Ausbildungsstätte zu vereinbarem Thema.

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none">• Die Studierenden kennen die Arbeitsgebiete, die betrieblichen Abläufe und sozialen Mechanismen in einem Unternehmen.• Sie haben die Tätigkeiten und die Arbeitsmethodik von Ingenieuren/innen im Unternehmen kennengelernt.
Fertigkeiten: <ul style="list-style-type: none">• Sie sind in der Lage Arbeitsergebnisse aufzubereiten, zu präsentieren und zu diskutieren.• Sie verfügen über ein Gespür für Zeitmanagement.• Sie können theoretische wissenschaftliche Kenntnisse praktisch anwenden.
Kompetenzen: <ul style="list-style-type: none">• Die Studierenden verfügen über die Kompetenz, im Team ergebnisorientiert und unter gegebenen zeitlichen Rahmenbedingungen zu arbeiten.• Sie können den Einfluss wirtschaftlicher und sozialer Faktoren auf die fachliche Arbeit akzeptieren und einkalkulieren.• Sie sind in der Lage, Rückschläge hinzunehmen, sinnvolle Kompromisse zu schließen und Hindernisse zu überwinden.• Sie sind in der Lage, theoretische Erkenntnisse auf ihre praktische Anwendbarkeit kritisch zu hinterfragen.• Sie sind in der Lage eingefahrene Abläufe in der Praxis vor dem Hintergrund theoretischer Erkenntnisse kritisch zu hinterfragen.
Angebotene Lehrunterlagen
Merkblatt zum Ablauf des Praxissemesters
Literatur
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
Auf der Webseite der Fakultät steht den Studierenden unter der Rubrik "Praktikum" ein umfassendes Merkblatt zum Ablauf des Praxissemesters zur Verfügung.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Praxisseminar (Seminar of Practical Course)		PS	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Manfred Hopfenmüller		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Professoren AM		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Seminar			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
5.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
12h	48h

Studien- und Prüfungsleistung
Präsentation zum Praktikum im Umfang von 10 - 15 Minuten Zulassungsvoraussetzung: Das <i>Praktikum</i> (Modul Nr. 22.1) muss mit Erfolg absolviert sein.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
Die Studierenden berichten in einem Kurzvortrag im Kreis von Studierenden und Lehrenden über ihre praktische Tätigkeit. Dem schließt sich eine kurze Diskussion an.
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Studierenden haben einen potentiellen Arbeitgeber und die verschiedenen Arbeitsfelder im Unternehmen kennengelernt und sich entsprechendes Wissen über das Unternehmen angeeignet. <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Studierenden können vor Publikum die Ziele, den Inhalt und die Ergebnisse der eigenen fachlichen Arbeit knapp, klar und überzeugend mündlich präsentieren. Sie verfügen über Fertigkeit im Umgang mit Präsentationstechniken. Die Studierenden können zu einer Fachdiskussion beizutragen. <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> Sie zeigen Souveränität und verlieren auch bei kritischen Fragen nicht den Faden.

Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Analogtechnik (Analogue Circuit Design)		AT / Nr.14
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dieter Kohlert	Elektro- und Informationstechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	2.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Grundlagen des Moduls <i>Elektronische Bauelemente</i> (Modul Nr. 8), komplexe Wechselstromrechnung

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Analogtechnik (Analogue Circuit Design)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Analogtechnik (Analogue Circuit Design)		AT	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dieter Kohlert		Elektro- und Informationstechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dieter Kohlert		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht und Übung			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Kleinsignalmodelle der aktiven elektronischen Bauelemente, Berechnung von Arbeitspunkten, Berechnung der Eigenschaften von Grundsaltungen mit Hilfe von Kleinsignalmodellen, Übungen in Simulation und Hardwareaufbau • Grundsaltungen auf der Basis des idealen Operationsverstärkers, Eigenschaften des realen Operationsverstärkers, Einfluss auf das Schaltungsverhalten, Übungen in Simulation und Hardwareaufbau
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden haben Einblick in Simulationswerkzeuge Fertigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden verfügen über eigene praktische Erfahrungen durch Übungen in Simulation und Hardwareaufbau Kompetenzen: <ul style="list-style-type: none"> • Sie verstehen die Grundlagen der analogen Schaltungstechnik sowohl auf Transistor- als auch Operationsverstärkerebene

Angebotene Lehrunterlagen
Vorlesungsskript: „Analog- und Digitaltechnik“, D. Kohlert, 2009
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Grey, Meyer: „Analysis and Design of Analog Integrated Circuits“, New York: Mc Graw Hill• Tietze, Schenck: „Halbleiterschaltungstechnik“, Springer• Siegl: „Schaltungstechnik“, Springer

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Bachelorarbeit (Bachelor's Thesis)		BA / Nr.31
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Dekan Fakultät AM	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
7.	2.	Pflicht	12

Verpflichtende Voraussetzungen
Das Thema der Bachelorarbeit wird frühestens im sechsten Studiensemester unter der Voraussetzung, dass die Praxisbegleitenden Lehrveranstaltungen, das berufsbegleitende Praktikum sowie das Praxisseminar erfolgreich absolviert sind, ausgegeben.
Empfohlene Vorkenntnisse
Einschlägige fachliche und methodische Vorkenntnisse aus dem Studium.

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Bachelorarbeit		12

Hinweise zur Belegungspflicht oder zu Optionen
Bearbeitungszeit und weitere Bestimmungen siehe SPO § 11 und APO § 19

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Bachelorarbeit		BA	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Dekan Fakultät AM		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
BetreuerIn Bachelorarbeit		in jedem Semester	
Lehrform			
Selbständige Ingenieursarbeit mit Dokumentation			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
7.		deutsch/englisch	12

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
	360h

Studien- und Prüfungsleistung
Bachelorarbeit: Vorlage in schriftlicher Form, gebunden in 2-facher Ausfertigung
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
In der Bachelorarbeit lösen die Studierenden selbstständig mit ingenieurmäßiger Arbeitsweise und auf Basis wissenschaftlicher Methodik ein Problem, das kumulatives Fachwissen und die im Studium erworbenen Fähigkeiten und Fertigkeiten herausfordert. Das Thema kann frei gewählt werden und in Industrie oder an der OTH Regensburg bearbeitet werden. Dozenten/innen sowie Industrieunternehmen bieten regelmäßig Themen zur Bearbeitung an. In jedem Fall fungiert ein/e Dozent/in der OTH Regensburg als Betreuer/in, Ansprechpartner/in und Prüfer/in. Die Arbeit ist schriftlich zu dokumentieren, die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Qualität der Ergebnisse und der Dokumentation.
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bachelorarbeit weisen Studierende folgende Qualifikationen nach: <ul style="list-style-type: none"> • Die Fähigkeit, eine komplexe Aufgabenstellung aus dem Fachgebiet selbstständig in gegebenem Zeitrahmen zu lösen. • Kompetenz in der Anwendung theoretischer wissenschaftlicher Kenntnisse als Ingenieur/in. • Befähigung zum Einarbeiten in Fachgebiete, die im Studium nicht behandelt wurden. • Fähigkeit, Rückschläge hinzunehmen, sinnvolle Kompromisse zu schließen und Hindernisse zu überwinden. • Fertigkeit in der schriftlichen technisch-wissenschaftlichen Dokumentation.

Literatur
Je nach Thema
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
Die Bachelorarbeit darf mit Genehmigung des Aufgabenstellers oder der Aufgabenstellerin in Englisch abgefasst werden.

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Defektdichte-Engineering		DE / Nr. 31
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner Prof. Dr. Ernst Wild	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
7.	2.	Pflicht	5

Empfohlene Vorkenntnisse
Die Chemie- und Physik-Module der Semester 1 bis 6.

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Defektdichte-Engineering	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Defektdichte-Engineering		DE
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner Prof. Dr. Ernst Wild	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Alfred Lechner Prof. Dr. Ernst Wild	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
7.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Zusammenhänge Ausbeute, Fläche und Defektdichte • Testen von Bauteilen unter besonderer Berücksichtigung von Speicherchips • Ausfallursachen chemischer und physikalischer Natur und deren Analyse
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<ul style="list-style-type: none"> • Kenntnis der Messmethoden für Ausbeute • Kenntnisse über theoretische Modelle zur Berechnung von Ausbeuten • Kenntnisse über chemische und physikalische Ursachen von Ausfällen, die bei einem mikrosystemtechnischen Fertigungsprozess entstehen können • Kenntnisse über Kristallstrukturfehler und metallische und organische Kontaminationen • Kenntnisse zum Finden von Ausfällen auf Scheibenebene und deren Analyse • Kenntnisse über chemische und physikalische Analysemethoden • Kenntnisse über Reinigungskonzepte zur Beseitigung von Kontaminationen
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- F. Beck, Integrierte Halbleiterschaltungen, VCH Verlag
- R. Eckert, Fehleranalyse an Halbleiterschaltungen, Expert Verlag, Sindelfingen
- S. M. Sze, VLSI Technology Mc Graw (1988)
- H. F. Hadamovsky, Werkstoffe der Halbleitertechnik, VEB Leipzig
- S. Wolf, R. Tauber, Silicon Processing for the ULSI Era

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Digitaltechnik mit Praktikum (Digital Electronics with Laboratory Exercises)		DTP / Nr.18
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dieter Kohlert	Elektro- und Informationstechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Beherrschung des Stoffes der Module <i>Elektronische Bauelemente</i> (Modul Nr.8) und <i>Analogtechnik</i> (Modul Nr. 14)

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang	Arbeitsaufwand
		[SWS o. UE]	[ECTS-Credits]
1.	Digitaltechnik (Digital Electronics)	2 SWS	3
2.	Praktikum Digitaltechnik	2 SWS	2

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Digitaltechnik (Digital Electronics)		DT
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dieter Kohlert	Elektro- und Informationstechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dieter Kohlert	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2 SWS	deutsch	3

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	60h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
tbd
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
tbd
Angebotene Lehrunterlagen
tbd
Lehrmedien
tbd
Literatur
tbd

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Praktikum Digitaltechnik		PDT	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dieter Kohlert		Elektro- und Informationstechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dieter Kohlert		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Praktikum			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Praktischer Leistungsnachweis mit Erfolg: tbd.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
Literatur

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Fachbezogenes Wahlpflichtmodul 1 (Mandatory Subjectspecific Elective Module 1)		WP 1 / Nr.13
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Lehrpersonen im FWPF-Modul	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	2.	Wahlpflicht	5

Inhalte
Je nach Lehrveranstaltung
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Je nach Lehrveranstaltung

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Analytische Chemie (Analytical Chemistry)	4 SWS	5
2.	Rastermikroskopie (Scanning Microscopy)	4 SWS	5
3.	Security Studies	4 SWS	5
4.	Sensorprinzipien (Fundamental Principles of Sensor Technology)	4 SWS	5
5.	Sensors in Biotechnology	4 SWS	5
6.	Technikfolgenabschätzung (Technology Assessment)	4 SWS	5

Hinweise zur Belegungspflicht oder zu Optionen
Das semesteraktuelle Angebot regelt der jeweilige Studienplan

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Analytische Chemie (Analytical Chemistry)		AC
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Walter Rieger	Allgemeinwissenschaftliches Programm	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Walter Rieger	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Allgemeine und theoretische Grundlagen • Grundbegriffe der Analytischen Chemie • Fehler und Fehlerbetrachtung • Analytische Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung • Probenvorbereitung • Gravimetrie • Titrimetrie: Säure-Basen-Titrationen, Komplexometrie, Redoxitrationen • Kinetische Analyse • Enzymatische Analyse • Immunchemische Analyse • Polymerase Chain Reaction (PCR) • Elektrochemische Analysenmethoden: Konduktometrie, Potentiometrie, Elektrolyse, Elektrogravimetrie, Coulometrie, Polarographie, Voltammetrie, Amperometrie
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Funktionsweisen, Bedeutung und Anwendungen chemisch-analytischer Methoden
Fertigkeiten:

- Fertigkeit, analytisch chemische Problemstellungen zu analysieren und geeignete Verfahren zur Lösung auszuwählen
- Fertigkeit Fehlerabschätzung und statistische Methoden anzuwenden

Kompetenzen:

- Verständnis und Anwendung analytisch-chemischer Methoden auf konkrete Problemstellungen
- Kompetenz der kritischen Beurteilung von Messwerten

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- G. Schwedt, Analytische Chemie -Grundlagen, Methoden und Praxis, Thieme Verlag, 2. Auflage, 2008
- Jander/Blasius, Lehrbuch der analytischen und präparativen anorganischen Chemie, Hirzel, Stuttgart; Auflage: 16., überarb. A. (1. März 2006)
- M. Otto, Analytische Chemie, Wiley-VCH, 4. Aufl., 2011
- Gerdes, Eberhard, Qualitative Anorganische Analyse: Ein Begleiter für Theorie und Praxis, Springer, Berlin; Auflage: 2., korr. u. überarb. A. 2013
- Riedel, Erwin, Allgemeine und Anorganische Chemie, de Gruyter Berlin; 11. Auflage 2013

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Rastermikroskopie (Scanning Microscopy)		RM	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Ernst Wild		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Ernst Wild		in jedem Semester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Optische Mikroskopie • Funktion und Aufbau eines Rasterelektronenmikroskops • Wechselwirkung des Elektronenstrahls mit Materie • Spezielle Verfahren in der Rasterelektronenmikroskopie • Probenpräparation • Funktion und Aufbau eines Rasterkraftmikroskops • Betriebsarten eines Rasterkraftmikroskops • Wechselwirkung der Spitze mit der Probenoberfläche
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Kenntnis der Abbe'schen Theorie bei der Bildentstehung der optischen Mikroskopie • Kenntnis des Aufbaus eines Rasterelektronenmikroskops • Kenntnis der physikalischen Prozesse bei der Bildentstehung • Kenntnis der Röntgenfluoreszenz und des Auger Effekts und deren Anwendung bei der Materialanalyse • Kenntnisse zur Präparation von anorganischen Proben • Kenntnis des Aufbaus eines Rasterkraftmikroskops • Kenntnis der Wechselwirkung zwischen Spitze und Probe • Kenntnis der Betriebsarten Rasterkraftmikroskops • Kenntnisse über Artefakte in der Abbildung

Fertigkeiten:

- Fähigkeit zur praktischen Bedienung eines Rasterelektronenmikroskops
- Fähigkeit der Deutung rasterelektronenmikroskopischer Bilder

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- L. Reimer, G. Pfefferkorn Rasterelektronenmikroskopie, Springer Verlag
- W. Schäfer, G. Terlecki, Halbleiterprüfung, Hüthig Verlag
- F. Beck, Präparationstechniken für die Fehleranalyse an integrierten Halbleiterschaltungen, VCH- Wiley Verlag
- E. Mayer, H. J. Hug, Scanning Probe Microscopy - The Lab on a Tip, Springer Verlag

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Security Studies		SES
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Markus Bresinsky	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Markus Bresinsky	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	englisch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Written essay in English (1500 words)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Administration & Organization; Introduction • Develop definition of security and security challenges • Introduction into planning and analysis tools • Definition of subject matter of interest • Developing work plan and research design • Work groups and plenum discussion • Symposium
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>The classical school of Security Studies is concerned with the topic of nation states and their security in an international system characterized by anarchy, insecurity, crisis, and war. Nevertheless, there exists a series of so-called non-traditional security threats, which are no longer, stop at borders of nation states and are therefore subject of a more comprehensive approach in analysis and research.</p> <p>The SES course will address these challenges by focusing in an international topic, which is highly relevant for international security.</p> <p>This term we will analyze and discuss the domain of cyber security and their relevance for international relation, business and societies. The course is in cooperation with KPMG Cologne 'Cyber Security'.</p> <p>By using this topic as a case study, the course will address two aspects. Firstly students will learn to create a situational picture, assess the information and develop possible future</p>

scenarios of the ongoing events. Secondly students will apply methods, tools, and best practice for the analysis and the development of decision support products. The last aspect will address the processes of analysis as known in policy and business intelligence.

Students are invited to develop their own problem statements and topics for research. As the course is designed as research based learning, students are expected to prepare information and reading outside the course sessions.

Competencies:

- Understand the issues of non-traditional security challenges
- Know how to identify a non-traditional security challenge in specific domain of politics or business.
- Know how to analyze the actor, structures and processes of international security challenges
- Know how to support an analysis and intelligence cycle by creating intelligence products
- Know how to apply specific analysis procedures (e.g. Business Process Models, Scenario Technique)
- Know how to apply specific software tools (e.g. Visual Understanding Environment, Scenario Wizard, ARIS Express etc.)
- Know how to document and log results on e-learning platform
- Know how to present results to plenum and work groups
- Improve English conversation, reading and writing

Angebotene Lehrunterlagen

Handapparat in der Bibliothek

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer, spezifische Softwaretools

Literatur

- Collins, Alan (2010): Contemporary Security Studies. Oxford [u.a.]: Oxford Univ. Press.
- Balzacq, Thierry (2015): Contesting security. strategies and logics. London [u.a.]. Routledge.
- Williams, Paul [Hrsg.] (2013): Security studies. 2. Ed. London [u.a.]. Routledge.

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Reading of literature, scientific working style and self-commitment to work groups is mandatory! The course will be held together with students of the study program “International Relations and Management”.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Sensorprinzipien (Fundamental Principles of Sensor Technology)		RM
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Oliver Steffens	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Oliver Steffens	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Referat 10 Min. (m.E.)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ol style="list-style-type: none"> 1. Einleitung – Grundbegriffe und Klassifikation von Sensoren 2. Kenngrößen von Sensoren 3. Systemtheorie/Fourier-Transformation; Grundstrukturen der Schaltungstechnik 4. Mechanisch-elektrische Wandler 5. Thermisch-elektrische Wandler 6. Opto-elektrische Wandler 7. Magneto-elektrische Wandler 8. Spezielle Sensoranwendungen
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden kennen eine breite Palette an Anwendungsfeldern für Sensoren und die zugrundeliegenden physikalischen Prinzipien sowie deren technische Umsetzung; • Sie kennen Kenngrößen für industrielle Sensoren und deren Einflüsse auf das Sensorsignal <p>Fertigkeiten:</p>

- Sie können einfache Auswerte-Schaltungen und Signalverstärkerschaltungen analysieren und funktionale Zusammenhänge zwischen Sensorgröße und Signal berechnen;
- Sie sind in der Lage, Signale zwischen Zeit- und Frequenzbereich zu transformieren und Übertragungsfunktionen zu berechnen.

Kompetenzen:

- Die Studierenden können entscheiden, welche Sensorprinzipien für welche Sensoraufgaben geeignet sind und Vor- und Nachteile (z.B. Genauigkeit, Trägheit, Kosten, Baugröße) verschiedener Sensortechniken erkennen.
- Sie sind in der Lage, die in der Veranstaltung vermittelten allgemeinen Prinzipien von den exemplarisch vorgestellten Beispielen auf weitere (nicht behandelte) Sensortechniken zu übertragen.

Angebote Lehrunterlagen

Vorlesungsskript mit Übungen, Moodle-Kursraum

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Fraden, J.: Handbook of modern Sensors. 3rd ed., Springer-Verlag, New York (2010)
- von Ardenne, M., Musiol, G., Reball, S.: Effekte der Physik. Harri Deutsch Verlag, Frankfurt/Main (2005)
- Glück, M.: MEMS in der Mikrosystemtechnik. Aufbau, Wirkprinzipien, Herstellung und Praxiseinsatz mikroelektromechanischer Schaltungen und Sensorsysteme (Lehrbuch Elektronik). Teubner, Wiesbaden (2005)
- Schmidt, W.-D.: Sensorschaltungstechnik. Vogel Buchverlag, Würzburg (2007)
- Elbel, T.: Mikrosensorik. Vieweg Verlag, Braunschweig/Wiesbaden (1996)

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Nach Möglichkeit wird während des Semesters eine Exkursion zu einer Sensormesse o.ä. angeboten.

Empfohlene Vorkenntnisse aus den Modulen: Mathematik 1 + 2 (Module Nr. 3+7) ,
Elektronische Bauelemente (Modul Nr. 8), Technische Physik 1 + 2 (Module Nr. 4+10)

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Sensors in Biotechnology		SB
Verantwortliche/r	Fakultät	
Dr. Rezan Fahrioglu Yamaci (LB)	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Dr. Rezan Fahrioglu Yamaci (LB)	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	englisch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Klausur 90 Minuten sowie ein praktischer Leistungsnachweis in Form eines Vortrags
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Introduction to sensors • Sensors in industry and agriculture • Sensors in environment • Sensors in clinic • Biosensors • Next generation biomedical sensors
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Objective</p> <ul style="list-style-type: none"> • Students will have an insight to the uses of sensors in different fields, mainly biotechnology and clinical applications. These include diagnosis and treatment of disease conditions as well as disease stage monitoring. • They will experience the contribution of developing sensor technologies in improving human life style and quality. <p>Skills</p> <ul style="list-style-type: none"> • They will learn to research and discuss their findings, also in the form of presentations. • They will learn reading and discussing relevant research articles <p>Competence</p>

<ul style="list-style-type: none">• Through preparing a group presentation they will do research on a given topic, learn to investigate deep and improve team building skills.• They will improve their level of English in understanding, reading, writing and communicating• Presentation and conviction skills as well as confidence will be enhanced.
Angebotene Lehrunterlagen
Lecture notes (Powerpoint slides)
Lehrmedien
Projector
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• J. Vetelino and A. Reghu. Introduction to Sensors, CRC press, 2011• H. Eren and JG. Webster. Telemedicine and Electronic Medicine, CRC Press, 2017• F. Toldra and LML. Nollet. Advances in Food Diagnostics, Wiley-Blackwell, 2017• C. Kumar. Nanomaterials for Biosensors, Wiley-VCH, 2007• B. Eggins. Biosensors, An introduction, Wiley Teubner, 1996
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
Recent publications relevant to the topic will be provided

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Technikfolgenabschätzung (Technology Assessment)		TF
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Karsten Weber	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Karsten Weber (LB)	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachbezogenen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Poster, Vortrag 30 Minuten, Handout für Vortrag
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Geschichte und Entwicklung der institutionalisierten Technikfolgenabschätzung (TA) • Institutionen, Ziele und Aufgaben der TA • Grundsätzliche Vorgehensweisen • Methoden der TA • Bearbeitung eines kleineren TA-Projekts in Teamarbeit mit Anwendung einiger Methoden • Dokumentation und Vorstellung der Ergebnisse
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technik • Kenntnisse zu den Vorgehensweisen der TA <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anwendung grundlegender Methoden der TA • Einschätzung der Verlässlichkeit entsprechender Forschungsergebnisse • Multimodale Präsentation von Forschungsergebnissen <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eigenständige Durchführung eines TA-Projekts

• Projektkoordination und Teamarbeit
Angebotene Lehrunterlagen
Foliensätze, Quellen, Übungsblätter
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Grunwald, A., 2002. Technikfolgenabschätzung: Eine Einführung, Berlin: Edition Sigma.• Bechmann, G., 1996. Praxisfelder der Technikfolgenforschung: Konzepte, Methoden, Optionen, Frankfurt/Main, New York: Campus.• Simonis, G. hrsg., 2013. Konzepte und Verfahren der Technikfolgenabschätzung, Wiesbaden: Springer Fachmedien.

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Fachbezogenes Wahlpflichtmodul 2 (Mandatory Subjectspecific Elective Module 2)		WP 2 / Nr.23
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Lehrpersonen im FWPF-Modul	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	2.	Wahlpflicht	5

Empfohlene Vorkenntnisse
Je nach Lehrveranstaltung

Inhalte
Je nach Lehrveranstaltung
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Je nach Lehrveranstaltung

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang	Arbeitsaufwand
		[SWS o. UE]	[ECTS-Credits]
1.	Bioanalytik und Genanalytik (Bioanalysis and Genetic Analyses)	4 SWS	5
2.	Kernphysikalische Methoden in Sensorik und Analytik (Methods of Nuclear Physics in Seensorics and Analysis)	4 SWS	5
3.	Optische Sensorik (Optical Sensors)	4 SWS	5
4.	Projektarbeit (Project Work)	4 SWS	5
5.	Spurenanalytik auf Siliziumscheiben (Trace Analysis on Silicon Wafers)	4 SWS	5
6.	Technische Optik (Applied Optics)	4 SWS	5

Hinweise zur Belegungspflicht oder zu Optionen
Das semesteraktuelle Angebot regelt der jeweilige Studienplan.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Bioanalytik und Genanalytik (Bioanalysis and Genetic Analyses)		BG
Verantwortliche/r	Fakultät	
Dr. Petra Bastian (LB)	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Dr. Petra Bastian (LB)	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Einführung in Biologische und genetische Zusammenhänge: Grundlage der Analytik von und mit Biomolekülen • Instrumentelle Analytik: Spektroskopische und mikroskopische Methoden, Chromatographie, Elektrophorese, Kapillarelektrophorese • Enzymatische Analysemethoden mit katalytischen Interaktionen • Immunologische Analysemethoden, Interaktionsanalytik • Biosensorik • Funktionsanalytik: Genom- und Sequenzanalyse, Proteomics, Metabolomics, Peptidomics, Interactomics, Toponomics; Ansatzpunkte moderner Simulationstechniken und informatischer Datenverarbeitung; Internationale Datenbanken • Einsatz und Kombinationsmöglichkeiten zur Erforschung komplexer biologischer und genetischer Zusammenhänge anhand ausgewählter Beispiele
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierende verfügen über Kenntnisse von Biomolekülen und haben ein Verständnis von grundsätzlichen biologischen und genetischen Zusammenhängen • Sie kennen moderne Bio- und Genanalytische Methoden, deren Einsatzmöglichkeiten und Anwendungsgebiete, sowie die Schnittpunkte zu Sensorik und der Mikrosystemtechnik

- Sie kennen die biologischen und genetischen Fortschritte, die durch die Entwicklung moderner analytischer Methoden gewonnen werden konnten, und die wiederum zur Weiterentwicklung dieser Methoden führten;
- Sie haben Überblick über die Bio- und Genanalytik und die damit verbundenen Fortschritte

Kompetenzen:

- Grundlegende Kenntnisse, um sich als Ingenieur der Sensorik oder Mikrosystemtechnik zukünftig in dieses Gebiet einbringen zu können

Angebotene Lehrunterlagen

Skripte

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

Optional:

- Friedrich Lottspeich, Joachim W. Engels, Bioanalytik, Spektrum Akad. Verlag, 3. Auflage 2012;
- Reinhard Renneberg, Bioanalytik für Einsteiger, Spektrum Akad. Verlag 2009;
- Rolf D. Schmid, Taschenatlas der Biotechnologie und Gentechnik, Wiley-VCH, 2. Auflage 2006
- Eberhard Passarge, Taschenatlas der Genetik, Thieme Verlag 2003;

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Kernphysikalische Methoden in Sensorik und Analytik (Methods of Nuclear Physics in Seensorsics and Analysis)		WPG
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Thomas Peterreins	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Thomas Peterreins	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen Demonstrationsexperimente im Labor		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Relativistik und Quantenphysik:

Zeitdilatation, Beziehung zwischen Energie sowie Impuls und Ruhemasse, Quantisierung, Unschärferelation, Tunneleffekt, quantenmechanische Drehimpulse und Spin

Der Atomkern:

Elementarteilchen, Kernbestandteile, Bindung, Isotopen, Kernmodelle, Weizsäcker'sche Massenformel, Massendefekt und Bindungsenergie, Wechselwirkung mit Atomhülle, Einfluss auf Spektren, Hyperfeinstruktur

Kernzerfall:

Arten, Mechanismen, Erhaltungssätze (wann ist Zerfall möglich ?), Emission, Energiespektren, Halbwertszeit und Lebensdauer, Nuklidkarte, Verzweigungen, Zerfallsketten und radioaktives Gleichgewicht, Röntgenphotonen, oft verwendete Strahlungsquellen, Kernreaktionen

Wechselwirkung Strahlung – Materie:

Streuung, Ionisation und Anregung, Bethe-Bloch-Formel, Reichweite, Bragg-Peak, Besonderheiten bei Photonen (Photoeffekt, Comptoneffekt, Paarbildung, exponentielle Schwächung) und Neutronen, strahleninduzierte Materialveränderungen
Aspekte des Strahlenschutzes: Wechselwirkung mit Biomolekülen, LET-Wert, Schadensmechanismen, Dosisbegriff, Grenzwerte, Schutzmaßnahmen, Abschirmung

Detektoren für Strahlung:

Gasgefüllte Detektoren, Ionisationskammer, Proportionalzählrohr, Geiger-Müller-Zähler, Szintillationsdetektoren (flüssig, Plastik, Kristalle), Halbleiterdetektoren (Si- Li, HPGe, Oberflächensperrschichtzähler), mikrostrukturierte Si-Detektoren, Dosimeter, Neutronennachweis

Messtechnik:

Energiespektren für Röntgenstrahlen, Gammas, Beta- und Alpha-Teilchen, Timing, Koinzidenz, Ortsauflösung, Signaturen, Elektronik, Shaping, Statistik, Untergrund

Wissenschaftliche Anwendungen:

Materialanalyse, Röntgenbeugung, EDX, WDX, XRF, Neutronenaktivierungsanalyse, Datierung, Tracing, Massenspektrometrie, Mössbauereffekt

Technische Anwendungen:

Dickenmessung, Dichtemessung, radioaktive Markierung, technische Röntgenuntersuchung (Schweißnahtuntersuchung u.a.), Modifikation von Materialien, Bestrahlung von Lebensmitteln, radioaktive „Batterien“

Medizinische Anwendungen:

Bildgebung, Röntgen, CT, Kernmagnetische Resonanz, Ultraschall, Nuklearmedizin (Diagnose und Therapie), PET, Tumorbestrahlung, Tele- und Brachytherapie

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Quellen, Arten, Ausbreitung, Wirkung und Nachweis ionisierender Strahlung (inkl. Photonen und Neutronen) aus Kernen, der Atomhülle, dem Weltall, Teilchenbeschleunigern und Röntgenröhren

- Überblick über die Anwendungen ionisierender Strahlung, speziell für Sensorik und Analytik, sowie über die Strahlungsmesstechnik

Fähigkeiten:

- Rechnerische Behandlung des Zeitverhaltens in einfachen Zerfallsketten. Abschätzung von Reichweiten und Eindringtiefen. Umgang mit der relativistischen Kinematik in einfachen Fällen.
- Interpretation von Gammaskpektren

Kompetenzen:

- Die Studierenden haben Einsicht gewonnen in die besonderen Möglichkeiten und Grenzen kernphysikalischer Methoden und kennen evtl. konkurrierende Verfahren.
- Sie können das Risiko qualifiziert abschätzen.
- Sie verstehen, wie sich die Eigenschaften ionisierender Strahlung auf die Aussagekraft analytischer Methoden auswirken.

Angebotene Lehrunterlagen

Skript

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer, Demonstrationsexperimente im Labor

Literatur

- Stolz: Radioaktivität, Teubner 2005 (einführend)
- Hering: Angewandte Kernphysik, Teubner 1999 (weiterführend)
- Lilley: Nuclear Physics, Principles and Applications, Wiley 2001 (weiterführend)
- Shultis/Faw: Fundamentals of Nuclear Science and Engineering, Marcel Dekker 2002 (weiterführend, mit ausführlichem Tabellenteil)
- Knoll: Radiation Detection and Measurement, Wiley 2010 (behandelt Strahlungsdetektoren, sowohl einführend als auch umfassend)
- Tavernier: Experimental Techniques in Nuclear and Particle Physics, Springer 2010 (ähnlich Knoll, aber knapper)
- Bröcker: dtv-Atlas zur Atomphysik, Deutscher Taschenbuch-Verlag 1997 (viele erklärende Bilder, umfassende Thematik, aber nicht auf dem neuesten Stand)
- Goretzki: Medizinische Strahlenkunde, Urban & Fischer / Elsevier 2004 (verständlich gehaltener Überblick über die medizinischen Anwendungen)

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Bei der Behandlung der Grundlagen der Kernphysik und Atomphysik werden begleitend Lücken in den Kenntnissen der relativistischen und Quantenphysik geschlossen. Die Eigenschaften ionisierender Strahlung und deren Nachweis werden im Detail dargestellt. Anwendungen ionisierender Strahlung in verschiedensten Bereichen sowie Demonstrationen im Labor schließen das Modul ab. Reihenfolge und Umfang der behandelten Themen können je nach Vorkenntnissen und Interesse der Gruppe variieren.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Optische Sensorik (Optical Sensors)		OS
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Peter Bickel	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Peter Bickel	in jedem Semester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch/englisch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<p>1. Introduction</p> <p>2. Foundations of Optics Physics of Light (Maxwell equation, wave propagation, electromagnetic waves, polarization, plane waves, Gaussian Beam (paraxial wave equation), energy (pointing vector), free-space and waveguide propagation) Scattering: Rayleigh and Mie Theory Interaction of radiation with matter: Laser basics, Fresnel equations, power transmission and reflection The dielectrical function und optical properties of matter: Refractive index and absorption, metal optics, Plasmafrequenz, Photometry</p> <p>2.1 Properties of natural and technical light sources Blackbody radiation: Plank's laws of radiation Coherence (temporal, spatial)</p> <p>2.2 Geometrical Optics (reflection and refraction, internal reflection) Lenses, microscopy, telescopes, special lenses e.g. telecentric lens ... Controlling light: Pockels cell, optical diodes, Prisms, Birefringence</p> <p>2.3 Interference and diffraction: Michelson, Mach-Zehnder, Speckles ...</p> <p>3. Detection of Light Overview: Common detectors and their properties Noise in optical detection, S/N, NEP, Detectivity...</p> <p>4. Optical measurement techniques</p> <p>4.1 Distance measurement</p> <ul style="list-style-type: none">4.1.1 Time of flight4.1.2 Triangulation4.2.4 Confocal techniques <p>4.2 Velocity measurement, LDA Laser doppler anemometry</p> <p>4.3 Meas. surface properties: Profile measurement, roughness measurement</p> <p>4.4 Ellipsometry, Meas, Layer thickness ...</p> <p>4.5 Interferometry (incl. Speckle interferometry)</p> <p>4.6 Methods of spectroscopy</p> <ul style="list-style-type: none">4.6.1 IR spectroscopy4.6.2 Raman, CARS, BOXCARS ... <p>4.7 LIF and LIDAR</p> <p>5. Image processing methods – basics of Fourier optics</p> <p>5.1 Dark field and Schlieren photography</p>
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Knowledge:</p> <ul style="list-style-type: none">• The students have knowledge of light sources, the propagation of light through media and their properties to the detection of radiation.• They have deeper knowledge about distance measurement and surface characterization. <p>Skills:</p> <ul style="list-style-type: none">• The participants will learn to design optical ranging systems from some μm to some km.• Radiometric calculation of optical sensing systems.• The ability of designing optical system for measuring and detecting of radiation shall be acquired. <p>Competences:</p>

- The participants should be able to understand a variety of optical sensing methods and metrology application.
- Selection of suitable techniques for solving applied measurement tasks.
- Understanding of the physics of radiation detectors and their properties like wavelength range, noise, sensitivity.

Angebotene Lehrunterlagen

The script is partially available in English and German.
Full English script is in progress.

Lehrmedien

Board, Notebook, Beamer

Literatur

- A. Yariv: "Optical Electronics", Saunders College publishing, 1991
- J. Hawkes, I. Latimer: "Lasers, Theory and practice", Prentice Hall, 1995, ISBN 0-13-521493-9
- B.E.A. Saleh, M.C. Teich: Fundamentals of Photonics, Wiley, 1991
- Axel Donges, Reinhard Noll: „Lasermesstechnik“, Hüthig, Heidelberg
- Wolfgang Demtröder: „Laserspektroskopie“, Springer Verlag
- Jörg Hoffmann: „Handbuch der Messtechnik“, Hanser
- A.W. Koch et.al, „Optische Messtechnik an technischen Oberflächen“, Expert Verlag, ISBN 3-8169-1372-5
- F.L. Pedrotti, S.J. Leno Pedrotti: "Introduction to optics", Prentice Hall, New Jersey, 1987, ISBN 0-13-501545-6
- K.D. Moeller: "Optics", University science books, Mill Valley California, 1988, ISBN 0-935702-145-8

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Previous knowledge:

Basic Physik lectures (TP1, TP2)
Electro-dynamics, Maxwell equations, Planck black body radiation
Linear algebra, matrix and vector calculus
Technical Optics (TO)

Preferrable previous knowledge (optional and useful):

Basic facts of solid state physics
Photonics and laser technology (PL)
Basic knowledge of optoelectronics

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Projektarbeit (Project Work)		PKT	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Dekan Fakultät AM		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Professoren und Professorinnen der OTH		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht mit 80% Übungsanteil			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Mündliche Prüfung 30 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Projektorganisation, Projektstrukturierung, Projekt-Controlling • Fallbeispielorientierte Problem- und Zielanalyse • Datenerhebung und -darstellung, Schwachstellenanalyse • Zielorientierte Problembearbeitung und -lösung im Team unter Berücksichtigung von • methodischen, systemtechnischen und wertanalytischen Vorgehensweisen • Systematische Dokumentation der Ergebnisse und Präsentation des Projekts
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Die Studierenden wenden die im Studium und Praxissemester erlernten Kenntnisse und Fähigkeiten an einer individuellen Projektaufgabe mittlerer Komplexität an. Dabei sammeln Sie erste Erfahrungen mit einer lösungsorientierten, im zeitlichen Ablauf durch Meilensteine strukturierten Arbeitsweise aus der beruflichen Praxis.</p> <p>Die Studierenden können ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zielführend einsetzen, um auf eine strukturierte und planvolle Weise zu Lösungen für abgesteckte Problemstellungen zu kommen. Sie haben praktische Kenntnisse über den Planungsprozess und Projektablauf.</p> <p>Neben der Fähigkeit, ihre Arbeitsergebnisse gemäß einem Meilensteinplan zu erarbeiten und in geeigneter Form zu dokumentieren, haben die Studierenden soziale Kompetenzen und praktische Erfahrungen in Teamarbeit, Umgang mit projektinternen und externen Schnittstellen und zielorientierter Kommunikation durch den Abgleich mit anderen Akteuren.</p>

Angebotene Lehrunterlagen
je nach Projekt
Lehrmedien
je nach Projekt
Literatur
je nach Projekt

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Spurenanalytik auf Siliziumscheiben (Trace Analysis on Silicon Wafers)		SA
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Alfred Lechner	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Referat zu analytischen Geräten (10 Minuten)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

1. Einführung in die chemische Analytik

- Lambert - Beer - Gesetz

2. Schwingungsspektroskopie

- Infrarot - Spektroskopie
- Raman - Spektroskopie
- Gerätebeschreibungen
- Interpretation der Spektren

3. Ultra - Visible - Spektroskopie

- Russel - Saunders - Terme
- Gerätebeschreibung
- Spektren von Atomen
- Spektren von Übergangskomplexen
- Spektren von organischen Molekülen

4. Atomabsorptionsspektroskopie

- Gerätebeschreibung
- Quantitative Analyse von metallischen Kontaminationen
- Oberflächenanalyse von Siliziumscheiben (V.P.D.)

5. Chromatographie

- Prinzip der Chromatographie
- Gaschromatographie
- Gerätebeschreibung
- Auswertung von Spektren (qualitativ und quantitativ)
- Ionenchromatographie
- Gerätebeschreibung
- Quantitative Bestimmung von Ionen

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Die Studierenden kennen die Wechselwirkung von Strahlung und Materie.
- Die Studierenden kennen die quantenmechanischen Zusammenhänge in der Schwingungsspektroskopie, Mikrowellen und UV-VIS Spektroskopie.
- Sie kennen die energetischen Schematas, wie z.B. "Russel Saunders Terme".
- Sie kennen die verschiedenen analytischen Geräte, die im Fachgebiet zum Einsatz kommen.

Fertigkeiten:

- Die Studierenden verfügen über vertiefte Fertigkeiten in der zielführenden Anwendung analytischer Gerätschaften auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie.

Kompetenzen:

- Die Studierenden sind in der Lage Spektren zu interpretieren und Schlussfolgerungen zu ziehen.
- Sie verfügen über die Kompetenz zur quantitativen und qualitativen Bestimmung von Stoffen mittels wichtiger analytischer Geräte.
- Sie sind in der Lage mittels geeigneter Präsentationstechniken komplexe analytische Themen zu präsentieren.

Angebotene Lehrunterlagen

Skript

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Heese, Meier, Zech, Spektroskopische Methoden in der organischen Chemie; Georg Thieme Verlag, 1991
- Jürgen Böcker, Chromatographie; Vogel Verlag, 1997
- Joachim Weiß, Ionenchromatographie Wiley-VCH Verlag, 2001
- Dr. D. Jensen, Grundlagen der Ionenchromatographie; Dionex Eigenverlag; 2000
- Ulrich Hilleringmann, Silizium-Halbleitertechnologie
- Hubert Hein, W. Kunze Umweltanalytik mit Spektrometrie und Chromatographie; Wiley-VCH Verlag, 2004
- Welz, Atomabsorptionsspektroskopie; Wiley-VCH Verlag, 1998

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Die Lehrveranstaltung wird begleitet von einem Praktikum in Infrarot-Spektroskopie, Raman-Spektroskopie, UV/VIS Spektroskopie.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Technische Optik (Applied Optics)		TO
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Peter Bickel	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Peter Bickel	in jedem Semester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht bei fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodulen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen - Maxwell und Fresnel Gleichungen • Das Photon – Planck'sche Strahlungsformel • Lichttechnische Berechnungen • Optische Eigenschaften der Materie: Brechungsindex und Absorptionskoeffizient • Metalloptik, Warum ist ein Stoff durchsichtig, ein anderer nicht? • Polarisierung, Reflexion und Streuung • Welleneigenschaften: Wellengleichung Interferenz und Beugung • Fresnel und Fraunhofer Beugung, Grundzüge der Fourieroptik • Strahlenoptik und optische Abbildung, Diskussion der Abbildungsfehler • Optische Komponenten: Linsen, Blenden, Aperturen, Spiegel, Prismen, Glasfasern und Mikrooptiken, Achromaten • Aufbau und Design von Linsensystemen für besondere Aufgaben z.B. telezentrische Objektive • Messung und Charakterisierung von Linsensystemen (MTF, Auflösung ...) • Optische Geräte: Fernrohr, Mikroskop, Projektor, Beleuchtungssysteme • Einführung in die Designsoftware OSLO mit Problemstellungen • Eigenschaften von Laserstrahlung: räumliche und zeitliche Kohärenz • Optische Resonatoren, Entstehung und Ausbreitung von Gaußstrahlen und deren Besonderheiten bei der Fokussierung

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kenntnisse der Eigenschaften optischer Geräte und deren Eigenschaften• Kenntniss der Erzeugung und Ausbreitungseigenschaften elektromagnetischer Strahlung und deren quantitative Berechnungsmethoden• Grundlagen für aufbauende und weiterführende Vorlesungen aus dem Bereich der optischen Messtechnik <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fähigkeit zur Anwendung der optischen Abbildung bis hin zu komplexen Linsensystemen• Fähigkeit einfache optische Systeme zu designen und zu dimensionieren <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verständnis der Grundlagen der modernen Optik sowie der optischen Eigenschaften optischer Materialien
Angebotene Lehrunterlagen
Skript
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Eugene Hecht, „Optics“, Addison Wesley, San Francisco, 2002, ISBN 0-8053-8566-5• Max Born And Emil Wolf, "Principles Of Optics", Pergamon Press, ISBN 0-08-018018-3• F.L. Pedrotti, S.J. Leno Pedrotti, “Introduction to optics”, Prentice Hall, New Jersey, 1987, ISBN 0-13-501545-6• K.D. Moeller, “Optics”, University science books, Mill Valley California, 1988, ISBN 0-935702-145-8• Bergmann, Schäfer, “Lehrbuch der Experimentalphysik” Band III, Optik, Walter de Gruyter Verlag• Bruce Walker, "Optical Engineering Fundamentals", SPIE Press Vol. TT30, 1997• Warren J. Smith, "Modern Optical Engineering (Second Edition)", McGraw-Hill 1990, ISBN 0-07-059174-1• "Modern Lens Design", co-authored with Genesee Optics Software (now Sinclair Optics), McGraw-Hill 1992, ISBN 0-07-059178-4• Robert R. Shannon, "The Art and Science of Optical Design", Cambridge University Press 1997, ISBN 0-521-58868-5• W.T. Welford, "Aberrations of Optical Systems", Adam Hilger 1986, ISBN 0-85274-564-8• A. Walther, "The Ray and Wave Theory of Lenses", Cambridge University Press 1995, ISBN 0-521-45
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
<p>Empfohlene Vorkenntnisse: Mathematik 1+2 (Module Nr. 3+7), Technische Physik 1+2 (Module Nr. 4+10)speziell Elektrodynamik. Kenntnis der Maxwellgleichungen ist wünschenswert.</p>

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.	
Festkörperphysik 1 (Solid State Physics 1)		FP 1 / Nr.15	
Modulverantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Martin Kammler		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Geometrie, Analysis, Mechanik, Elektrostatik, Schwingungen, chemische Bindungen, Halbleiter

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Festkörperphysik 1 (Solid State Physics 1)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Festkörperphysik 1 (Solid State Physics 1)		FP 1	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Martin Kammler		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Martin Kammler		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Kristallographische Grundlagen:

- Definition des Begriffs Kristall, Raumgitter, Basis, Einheitszelle, Elementarzelle und Wigner-Seitz-Zelle
- Gittersymmetrie und Bravaisgitter
- Kristallebenen, Millersche Indizes und Kristallrichtungen
- Beispiel: Die Kristallstruktur von Halbleitern

Reziprokes Gitter:

- Definition der reziproken Gittervektoren und reziproke Gittervektoren
- Eigenschaften des reziproken Gitters: Brillouin-Zone; Gitterebenen und Millersche Indizes, Fourier-Analyse
- Beispiel: Kubisches Kristallsystem

Strukturanalyse:

- Die Bragg-Bedingung
- Von Laue-Bedingung und Interpretation im reziproken Gitter
- Allgemeine Beugungstheorie
- Methoden der Strukturbestimmung mit Röntgenstrahlen: Laue-Verfahren, Pulververfahren und Drehkristallverfahren

Quantenphysikalische Grundbegriffe und Quantenstatistik:

- 1-dim, zeitunabhängige Schrödingergleichung und Kastenpotential
- Born'sche Interpretation der Wellenfunktion, Unschärferelation und Pauli-Prinzip
- Statistische Grundlagen: Boltzmann -, Fermi-Dirac- und Bose-Einstein-Verteilung

Gitterschwingungen

- Schwingungen der linearen Kette und Ableitung der Dispersionsrelation
- Quantisierung der Gitterschwingungen und Phononen
- Spezifische Wärme des Gitters (Debye-Modell)

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Kenntnisse:

- Kenntnis der Modelle und Methoden zur Beschreibung und zur Analyse der Eigenschaften von Kristallen.
- Kenntnis der Grundlagen der Quantenmechanik und der Quantenstatistik
- Kenntnis der Modelle zur Beschreibung der Gitterdynamik
- Kenntnis des Quasiteilchenskonzepts
- Kenntnis grundlegender Gleichungen und mathematischer Methoden der Festkörperphysik

Fertigkeiten:

- Sicheren Umgang mit den Fachbegriffen beherrschen
- Modelle der Festkörperphysik und die physikalische Bedeutung von Gleichungen erklären könne

Kompetenzen:

- Anwendung der im Rahmen der Modelle vorgestellten Gleichungen und mathematischer Methoden auf konkrete Problemstellungen der Festkörperphysik

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Kittel, Festkörperphysik, Oldenbourg Verlag
- Kopitzki, Einführung in die Festkörperphysik, Teubner Verlag
- Demtröder, Experimentalphysik 3, Springer Verlag
- Gross, Marx, Festkörperphysik, De Gruyter Verlag

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.	
Festkörperphysik 2 (Solid State Physics 2)		FP 2 / Nr.24	
Modulverantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Rupert Schreiner		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2.	Pflicht	5

Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Festkörperphysik 1 (Modul Nr.15)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Festkörperphysik 2 (Solid State Physics 2)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Festkörperphysik 2 (Solid State Physics 2)		FP 2	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Rupert Schreiner		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Rupert Schreiner		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht mit 15 bis 25% Übungsanteil			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<p>Elektronische Eigenschaften der Metalle</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drude Modell der elektrischen Leitfähigkeit und dessen Versagen • Quantisiertes Elektronengas und Sommerfeld Modell der elektrischen Leitfähigkeit • Hall Effekt • Energiebänder: Ursache der Energielücke; Semiklassisches Modell der Elektronendynamik (Kristallelektronen); Löcherkonzept und Eigenschaften der Löcher; Konzept der Energiebänder – Darstellungsformen; Metalle und Isolatoren <p>Halbleiter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atomare Struktur der Halbleiter, Leitungsband, Valenzband und Energielücke • Effektive-Masse-Näherung der Ladungsträger an den Bandkanten • Eigenleitung: Besetzung von Leitungs- und Valenzband; Boltzmann-Näherung; Elektrische Leitfähigkeit bei Eigenleitung; Hall-Effekt bei Eigenleitung • Störstellenleitung: n- und p-Leitung; Besetzung der Bänder bei N- und P-Leitung; Hall-Effekt bei Störstellenleitung • Der pn-Übergang: Der pn-Übergang in Gleichgewicht Der pn-Übergang mit äußerer Spannung, Gleichrichterdiode

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kenntnis physikalische Modelle zur Beschreibung der Eigenschaften von delokalisierten Elektronen in Festkörpern• Kenntnis der auf mikroskopischen Betrachtungen beruhenden Modelle zur Beschreibung folgender makroskopisch messbarer physikalischer Größen: Elektrische Leitfähigkeit; Thermische Leitfähigkeit; Wärmekapazität; Seebeck-Effekt (Thermoeffekt); Ladungsträgerdichten bei Halbleitern; Kennlinien von Halbleiter-Bauelementen• Kenntnis der physikalischen Prozesse an einem pn-Übergang <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sicheren Umgang mit den Fachbegriffen beherrschen• Modelle der Festkörperphysik und die physikalische Bedeutung von Gleichungen erklären können <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Anwendung der im Rahmen der Modelle vorgestellten Gleichungen und mathematischer Methoden auf konkrete Problemstellungen der Festkörperphysik
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Kittel, Festkörperphysik, Oldenbourg Verlag• Kopitzki, Einführung in die Festkörperphysik, Teubner Verlag• Demtröder, Experimentalphysik 3, Springer Verlag• Gross, Marx, Festkörperphysik, De Gruyter Verlag

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Konstruktion (Mechanical Component Design)		KO / Nr.12
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Thomas Peterreins	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	2.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Module: Mechanik aus <i>Technische Physik 1</i> (Modul Nr. 4), <i>Mathematik 1</i> (Modul Nr. 3)

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Konstruktion (Mechanical Component Design)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Konstruktion (Mechanical Component Design)		KO	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Thomas Peterreins		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Thomas Peterreins		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten StA: drei vorgegebene zeichnerische und konstruktive Übungen mit Erfolg; abzugeben bis spätestens 10 Tage vor Beginn der Prüfungen.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ol style="list-style-type: none"> 1) Regeln des Technischen Zeichnens; freihändiges Skizzieren, perspektivische Darstellungen 2) Grundzüge der Darstellenden Geometrie: Projektionen, wahre Länge, Durchstoßpunkte, Durchdringungen, Abwicklungen, Hilfsebenenverfahren, Hilfskugelverfahren 3) Toleranzen für Oberflächen, Maße, Form und Lage, freie Toleranzen, Allgmeintoleranzen, Hüllprinzip, Unabhängigkeitsprinzip 4) Zusammenwirken von Toleranzen; Passungen 5) Normung, Normenwerke 6) Grundbegriffe der Festigkeitslehre, Beanspruchungsarten: Zug, Druck, Schub, Knickung, Biegung, Torsion, Spannungs-Dehnungs-Diagramme, Grenzwerte, Sicherheit gegen Versagen 7) Balkenbiegung: Lagerreaktionen, Schnittreaktionen, Biegemoment, Verformung, Biegelinie 8) Klassen, Eigenschaften und Bezeichnungen häufig verwendeter Konstruktionswerkstoffe
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Regeln des technischen Zeichnens, Normenwerke.
Fertigkeiten:

- Lesen und Erstellen mittelschwerer technischer Zeichnungen, Anfertigung von Handskizzen und perspektivischen Darstellungen.
- Geschultes dreidimensionales Vorstellungsvermögen.
- Überschlägige Festigkeitsrechnung für einfache Belastungsfälle, vertiefte Beherrschung der Balkenbiegung.
- Fähigkeit zur Auswahl des geeigneten Konstruktionswerkstoffs.

Kompetenzen:

- Die Studierenden können einfache mechanische Bauteile z.B. für Anlagen der Mikrotechnik konstruieren.
- Die Studierenden verstehen, dass nichts „ganz genau“ hergestellt werden kann, wie sich die unvermeidlichen Toleranzen auswirken und wie eng man deren Grenzen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten setzen kann.
- Die Studierenden kennen die Grenzen der Festigkeitsrechnung, die aufgrund der zahlreichen mehr oder weniger gut erfüllten Annahmen gesetzt sind.

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Hoischen/Hesser: Technisches Zeichnen, Cornelsen
- Böttcher/Forberg: Technisches Zeichnen, Vieweg-Teubner
- Labisch/Weber: Technisches Zeichnen, Vieweg-Teubner
- Krause: Grundlagen der Konstruktion, Hanser
- Conrad u.a.: Taschenbuch der Konstruktionstechnik, Fachbuchverlag Leipzig
- Kurz/Hintzen/Laufenberg: Konstruieren, Gestalten, Entwerfen, Vieweg
- Geupel: Konstruktionslehre, Springer
- Assmann/Selke: Technische Mechanik 2: Festigkeitslehre, Oldenbourg
- Schnell/Gross/Hauger: Technische Mechanik 2: Elastostatik, Springer
- Jacobs: Werkstoffkunde, Vogel Fachbuch Verlag/Ischner/Singer: Werkstoffwissenschaften und Fertigungstechnik, Springer

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Je nach schulischen Vorkenntnissen, variiert der individuelle Aufwand für dieses Modul stark.

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Mess- und Prüftechnik mit Praktikum (Engineering Metrology and Test Engineering with Laboratory Exercises)		MPP / Nr.16
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Ernst Wild	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Grundlegende Kenntnisse aus der Physik

Inhalte
Siehe Folgeseiten
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseiten

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Mess- und Prüftechnik (Engineering Metrology and Test Engineering)	4 SWS	3
2.	Praktikum Mess- und Prüftechnik (Laboratory Exercises: Engineering Metrology and Test Engineering)	2 SWS	2

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Mess- und Prüftechnik (Engineering Metrology and Test Engineering)		MP
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Ernst Wild	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Ernst Wild	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	4 SWS	deutsch	3

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Zulassungsvoraussetzung: bestehen des Moduls <i>Praktikum Mess- und Prüftechnik</i> (Modul Nr. 16.2)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Einheiten, SI Einheitensystem • Messung der elektrischen Parameter Spannung Strom und Widerstand • Wechselstromkreise und Oszilloskop • Grundsaltungen mit dem Operationsverstärker • Fehler bei der Digitalisierung von Spannungsverläufen • Flip Flops und Zählerschaltungen • Digital- Analog und Analog- Digital Wandler • Sensoren und spezielle Messmethoden
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse über Gleichspannungskreise • Kenntnisse über die Schaltungsblöcke eines Oszilloskops und Kompetenz über den Einsatz eines Oszilloskops bei allgemeinen Messaufgaben • Kenntnisse über ideale Operationsverstärker mit externer Beschaltung • Kenntnisse über Fehlermöglichkeiten bei der Digitalisierung • Kenntnisse über Zählerschaltungen und deren zeitliches Verhalten • Kenntnis der Grundsaltungen von Digital- Analog und Analog- Digital Wandlern • Kenntnisse über die Anwendung von Sensoren

Kompetenzen:

- Kompetenz zur Messung von Strom und Spannung in einem Gleichstromkreis
- Kompetenz zur Anwendung von Brückenschaltungen
- Kompetenz zur Verwendung komplexer Größen in Wechselspannungskreisen

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- E. Schröder, elektrische Messtechnik, Hanser Verlag
- W. D. Cooper, A. D. Helfrick, elektrische Messtechnik, Wiley- VCH Verlag
- W. Schäfer, G. Terlecki, Halbleiterprüfung, Hüthig Verlag
- U. Tietze, Ch. Schenk, Halbleiter Schaltungstechnik, Springer Verlag

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Praktikum Mess- und Prüftechnik (Laboratory Exercises: Engineering Metrology and Test Engineering)		PMP
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Ernst Wild	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Ernst Wild	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Praktikum		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Praktischer Leistungsnachweis: Antestat und Testat müssen für jeden Versuch bestanden sein (m.E.) Das Bestehen des Praktikums ist Zulassungsvoraussetzung für die schriftliche Prüfung im Modul <i>Mess- und Prüftechnik</i> (Nr. 16.1)
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Einheiten, SI Einheitensystem • Messung der elektrischen Parameter Spannung Strom und Widerstand • Wechselstromkreise und Oszilloskop • Grundsaltungen mit dem Operationsverstärker • Fehler bei der Digitalisierung von Spannungsverläufen • Flip Flops und Zählerschaltungen • Digital- Analog und Analog- Digital Wandler • Sensoren und spezielle Messmethoden
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse über Gleichspannungskreise • Kenntnisse über die Schaltungsblöcke eines Oszilloskops und Kompetenz über den Einsatz eines Oszilloskops bei allgemeinen Messaufgaben • Kenntnisse über ideale Operationsverstärker mit externer Beschaltung • Kenntnisse über Fehlermöglichkeiten bei der Digitalisierung • Kenntnisse über Zählerschaltungen und deren zeitliches Verhalten

- Kenntnis der Grundsaltungen von Digital- Analog und Analog- Digital Wandlern
- Kenntnisse über die Anwendung von Sensoren

Fertigkeiten:

- Praktischer Aufbau einfacher Schaltungen
- Praktischer Umgang mit einfachen Bauelementen
- Durchführung elektrischer Messverfahren
- Umgang mit Multimeter, Oszilloskop, Pulsgenerator und rechnerunterstützten Auswerteverfahren

Kompetenzen:

- Kompetenz zur Anwendung von Brückenschaltungen.
- Kompetenz zur Verwendung komplexer Größen in Wechselspannungskreisen.
- Kompetenz zur Messung von Strom und Spannung in einem Gleichstromkreis

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- E. Schrüfer, elektrische Messtechnik, Hanser Verlag
- W. D. Cooper, A. D. Helfrick, elektrische Messtechnik, Wiley- VCH Verlag
- W. Schäfer, G. Terlecki, Halbleiterprüfung, Hüthig Verlag
- U. Tietze, Ch. Schenk, Halbleiter Schaltungstechnik, Springer Verlag

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Mikroelektroniktechnologie mit Praktikum (Microelectronics Technology with Laboratory Exercises)		MEP / Nr.11
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Martin Kammler	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.+ 4.	2.	Pflicht	8

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Module: Technische Physik 1 (Modul Nr. 4), Mathematik 1 (Modul Nr. 3), Werkstoffe 1 (Modul Nr. 6), Elektronische Bauelemente (Modul Nr. 8) Davon: Mechanik, Elektrostatik, Thermodynamik, chemische Bindungen, Radikale, elektronische Bauelemente, Halbleiterphysik und physikalischen Funktionsprinzipien von FETs

Inhalte
Siehe Folgeseiten
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseiten

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang	Arbeitsaufwand
		[SWS o. UE]	[ECTS-Credits]
1.	Mikroelektroniktechnologie (Microelectronics Technology)	6 SWS	6
2.	Praktikum Mikroelektroniktechnologie (Laboratory Exercises: Microelectronics Technology)	2 SWS	2

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Mikroelektroniktechnologie (Microelectronics Technology)		ME	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Martin Kammler		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Martin Kammler		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht mit 10 – 15% Übungsanteil			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3	6 SWS	deutsch	6

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
90h	120h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none">• Hintergründe und zeitliche Entwicklung der Halbleitertechnologie• Technologieknoten, Skalierungsfaktor und Roadmap• Halbleiterphysikalische Grundlagen: Dotierung von Halbleitern, Ladungsträgerdichte und Fermi-niveau; Der spezifischer Widerstand und der Schichtwiderstand• Grundmaterial: Kristallstruktur und Kristalldefekte; Herstellung von Einkristallen und Wafern; Spezialwafer und Nomenklatur• Thermische Oxidation: Modell nach Deal und Grove, Experimentelle Bestimmung der Parameter, Temperaturabhängigkeit der Oxidationsparameter; Weitere Einflüsse auf die Wachstumsrate, Segregation, Reaktortypen (Ofentechnik), Dünne Oxide• Lithographie• Fotolack / Photoresist, Resistprofil: Prozessablauf; Belichtungsverfahren• Ätztechnik: Grundlagen, Plasmaätzen, Chemisches Ätzen• Diffusion: Belegung und Eindiffusion, Atomistisches Modell und die Diffusionsgleichung, Diffusion bei konstanter Oberflächenkonzentration, Thermische Eindiffusion (konstante Dosis)• Implantation: Grundlagen der Ionenimplantation, Implantertypen, Implantationsschäden, Strukturierung / Maskierung und Defekte• Chemische Abscheidung aus der Gasphase: Grundlagen, CVD-Reaktortypen und CVD-Prozesse, Atomic Layer Deposition (ALD)• Physikalische Abscheidung aus der Gasphase (PVD): Hochvakuum, Aufdampfen, Sputtern• Chemisch Mechanisches Polieren (CMP): CMP-Prozessierung, Reinigung post CMP und Defekte post CMP• Metallisierung: Silicide, Aluminium (Al), Kupfer (Cu), Dual-Damascene-Prozess• CMOS-Gesamtprozess: SOI + STI + Cu-Technologie• Fertigung und Yield
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kenntnisse gängiger und progressiver Technologieprozesse auf Waferenebene zur Herstellung integrierter mikroelektronischer Schaltungen• Verständnis der physikalisch-chemischen Vorgänge bei den Einzelprozessen• Kenntnis wichtiger Prozessparameter• Überblick über aktuelle CMOS-Gesamtprozesse• Kenntnisse von Messmethoden zur Charakterisierung mikroelektronischer Schaltungen und in der Prozesskontrolle <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Auswahl geeigneter Technologieprozesse für die Herstellung mikroelektronischer Strukturen• Fähigkeit wichtige Prozessparameter zu berechnen oder abzuschätzen <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fähigkeit Technologieprozesse im Gesamtprozess zu verstehen und wichtige Parameter abzuleiten• Fähigkeit Technologieprozessen auf neuartige Produkte zu adaptieren

Angebote Lehrunterlagen
Skript zur Vorlesung Mikroelektroniktechnologie
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Widmann D., Mader H., Friedrich H.: Technologie hochintegrierter Schaltungen, Springer Verlag, Berlin, 1996• Ruge I.: Halbleitertechnologie, Springer Verlag, Berlin, 1984• Münch W.: Einführung in die Halbleitertechnologie, Teubner Verlag, Stuttgart, 1993• Hilleringmann U.: Silizium-Halbleitertechnologie, Vieweg+Teubner Verlag, 2008• Doering R., Nishi, Y.: Semiconductor Manufacturing Technology, CRC Press• Xiao H.: Introduction to Semiconductor Manufacturing Technology• Wolf S., Tauber R.N.: Silicon Processing for the VLSI Era, Vol. 1 Process Technology, Lattice Press• Sze S.M.: VLSI Technology, McGraw Hill• Sze S.M.: Physics of Semiconductor Devices, J.Wiley&Sons

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Praktikum Mikroelektroniktechnologie (Laboratory Exercises: Microelectronics Technology)		PME
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Martin Kammler	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Martin Kammler	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Praktikum		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Praktischer Leistungsnachweis (m.E.): 5 Ausarbeitungen (siehe Inhalte) mit Testat
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
Durchführung von 5 Versuchen aus folgendem Katalog: <ul style="list-style-type: none"> • Optische Mikroskopie • CV-Analyse • MOSFET-Parameter • Ellipsometrie • Schichtwiderstand • Weißlichtinterferenz • Solarzellenkennlinien
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse von Messmethoden zur Charakterisierung mikroelektronischer Schaltungen und Halbleiterstrukturen sowie in der Prozesskontrolle Fertigkeiten: <ul style="list-style-type: none"> • Anwendung von theoretischen Kenntnissen anhand experimenteller Untersuchungen • Praktische Fertigkeiten in ausgewählten Messmethoden • Auswertung und Deutung von Messergebnissen

- Fachgerechte Anfertigung von Versuchsberichten
- Fähigkeit zur grafischen Darstellung und statistischen Beurteilung von Messwerten

Kompetenzen:

- Durchführung von Messungen, Beurteilung von Messergebnissen
- Teamarbeit

Angebotene Lehrunterlagen

Skript zur Vorlesung Mikroelektroniktechnologie
Anleitungen zum Praktikum

Literatur

Anleitungen zum Praktikum und dort enthaltende Literaturhinweise

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Mikromechanik (Micromachining)		MN/ Nr.20
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Rupert Schreiner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	2.	Pflicht	6

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Mathematik 1+2 (Module Nr. 3+7), Technische Physik 1+2 (Module Nr. 4+10) und Werkstoffe 1 (Modul Nr. 6)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Mikromechanik (Micromachining)	4 SWS	6

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Mikromechanik (Micromachining)		MN	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Rupert Schreiner		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Rupert Schreiner		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht mit ca. 20% Übungsanteil			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	6

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	120h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Kontinuumsmechanik

1. Elastizität
 - 1.1 Isotrope Festkörper
 - 1.1.1 Mechanische Spannungen
 - 1.1.2 Deformationen
 - 1.2 Anisotrope Festkörper
 - 1.2.1 Aufbau von Kristallen
 - 1.2.2 Deformationen
2. Effekte zur mechanisch-elektrischen Signalwandlung
 - 2.1 Piezoelektrischer Effekt
 - 2.1.1 Piezoelektrische Materialien
 - 2.1.2 Mathematische Beschreibung
 - 2.2 Piezoresistiver Effekt
 - 2.2.1 Isotrope Festkörper
 - 2.2.2 Anisotrope Festkörper
3. Analytische Näherungslösungen der Elastizitätstheorie für spezielle Fälle
 - 3.1. Methode zur Bestimmung der mechanischen Verspannung einer dünnen Schicht auf einem runden Substrat
 - 3.2. Verformung einer isotropen rechteckigen dünnen Platte
 - 3.2.1 Allseitig eingespannte dünne Platte (Membran)
 - 3.2.2 Einseitig eingespannte dünne Platte (Biegebalken)

Einführung in die Mikrotechnologie mit Silizium und III-V-Halbleitern

1. Werkstoffe in der Mikrotechnologie
 - 1.1 Werkstofftypen
 - 1.2 Technologien
 - 1.3 Einfluss des Kristallaufbaus auf die Strukturierungsmöglichkeiten
2. Anisotropes nasschemisches Ätzen von Silizium und III-V-Halbleitern
 - 2.1 Anisotrope Nassätzlösungen
 - 2.2 Konzentrations- und Temperaturabhängigkeit
 - 2.3 Lage von Kristallebenen relativ zur Waferoberfläche
 - 2.4 Kantenätzraten auf Waferoberflächen
 - 2.5 Ätzgeometrien bei vorgegebenen Ätzmaskengeometrien
 - 2.6 Ätzgeometrien für lochartige Strukturen nach langer Ätzzeit
 - 2.7 Kompensationsstrukturen zum Schutz konvexer Ecken
 - 2.8 Ätzstoppschichten
3. Trockenätzverfahren
 - 3.1 Funktionsweise
 - 3.2. Mittlere freie Weglänge
 - 3.3 Anisotropie und Selektivität
 - 3.4 Plasma- und Barrelätzen
 - 3.5 Sputter- und Ionenstrahlätzen
 - 3.6 RIBE und CAIBE
 - 3.7 Reaktives Ionenätzen (RIE)
 - 3.8 DRIE
 - 3.9 Erhöhung der Anisotropie durch Seitenwandpassivierung

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none">• Kenntnis der grundlegenden mechanisch/physikalischen Eigenschaften von Si und III/V-HL
Fertigkeiten: <ul style="list-style-type: none">• Anwendung dieser Kenntnisse für das Design und die Herstellung halbleiterbasierter Mikrosysteme, Bauelemente und Mikrostrukturen• Theoretisches Hintergrundwissen dahingehend anwenden können, um die Strukturen in der Praxis zu realisieren
Kompetenzen: <ul style="list-style-type: none">• Selbstständige Dimensionierung und Entwurf von Mikrostrukturen für Anwendungen in der Halbleitertechnologie. Selbständiges Entwerfen von Prozessabläufen zur Herstellung der Strukturen und Bauelemente.
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Mescheder Ulrich: Mikrosystemtechnik, Teubner, Stuttgart, 2. Auflage 2004 (Mikromechanik und Technologie)• Robert E. Newnham: Properties of materials – Anisotropy, Symmetry, Structure, Oxford University Press, New York, 2005 (Kontinuumsmechanik, ausführlich)• Gerlach G., Dötzel W.: Einführung in die Mikrosystemtechnik, Hanser, 2006 (sehr knapp aber umfassend, viele Anwendungen, ausführliche Herleitungen zur Kontinuumsmechanik (Tensorrechnung) im Anhang)• Volklein F., Zetterer T.: Praxiswissen Mikrosystemtechnik, Vieweg, 2. Auflage 2006 (umfangreich, wenig Herleitungen, aber viele Anwendungen)
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
Empfohlene Vorkenntnisse: <i>Mathematik 1+2</i> (Module Nr. 3+7) <i>Technische Physik 1+2</i> (Module Nr. 4+10) und <i>Werkstoffe 1</i> (Modul Nr. 6)

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Optoelectronics		SO / Nr.29
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Rupert Schreiner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
7.	2.	Pflicht	8

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Engineering Mathematics, Physics, Material Science, Electronic Properties of Solids (Solid State Physics)

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Optoelectronics	8 SWS	8

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Optoelectronics		S0
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Rupert Schreiner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Rupert Schreiner	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht mit ca. 20%Übungsanteil		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
7.	8 SWS	englisch	8

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
120h	120h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte

Part I: Fundamentals

1. Light waves (Propagation of Light)
 - 1.1. Ray Tracing
 - 1.2. Light waves
 - 1.3. Maxwell-Theory of EM-waves
 - 1.4. Dielectric waveguides
2. Photons (Emission and Detection of Light)
 - 2.1 Discrepancies between Maxwell's Theory and Experiments
 - 2.2 Light as a particle (Photon), Light-Particle dualism
 - 2.3 Emission and absorption of light
 - 2.4 Illumination and color perception
 - 2.5 Optical gain and laser radiation
3. Opto-Semiconductors
 - 3.1 Energy band model; direct and indirect semiconductors
 - 3.2 Undoped and doped opto-Semiconductors
 - 3.3 Semiconductor diode theory
 - 3.4 Heterostructures / Technology of III-V-semiconductors

Part II: Devices and Applications

4. LED's
 - 4.1 Excess recombination
 - 4.2 Electro-optical characteristics
 - 4.3 Radiative and non-radiative recombination
 - 4.4 Measures for increasing efficiency
 - 4.5 Emission spectrum
 - 4.6 Modulation behavior
5. Optical Amplification and Semiconductor Lasers
 - 5.1 First Laser condition (inversion condition)
 - 5.2 Second laser condition (optical gain)
 - 5.3 Technical realization of inversion
 - 5.4 Electro-optical characteristic in cw-mode
 - 5.5 Emission spectrum
 - 5.6 wavelength tunable lasers
 - 5.7 Modulation behavior
6. Photodetectors, solarcells and semiconductor optical modulators
 - 6.1 Internal photoeffect
 - 6.2 Electrical characteristics of illuminated pn-junctions („photo elements“)
 - 6.3 Solar cells
 - 6.4 pin-photo diodes
 - 6.5 electro-optic modulators

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen

Knowledge:

- The students shall learn to know the fundamentals, the design, the technology and the operation of optoelectronic materials and modern optoelectronic devices (e.g. LED, Semiconductor Lasers, integrated optoelectronic circuits and photo-detectors).

Skills:

- Based on this knowledge they should be able to read scientific publications in this field and to understand the design, the fabrication process and the operation of optoelectronic devices.

Competences:

- The students should be able to design parts of optoelectronic components and structures by themselves. The students should be able to select and to choose suitable optoelectronic components for specific engineering applications. They should be able to join in and work together with an interdisciplinary team of physicists, chemists and engineers for the fabrication of modern optoelectronic devices.

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- S.M. Sze, K.K. Ng „Physics of Semiconductor Devices (3rd Ed.): Chapter 1, Chapter, Chapter 12 and Chapter 13”, Wiley, 2007
- D. Meschede “Gerthsen Physik”, Springer, 2015

Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung

Lehrveranstaltung und Prüfung in englischer Sprache.
Lecture and Exam in english.

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Packaging (Electronics Packaging)		PA / Nr.17
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Thomas Peterreins	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Technische Physik 1 (Modul Nr. 4), Technische Physik 2 mit Praktikum (Modul Nr. 10), Allgemeine und Anorganische Chemie mit Praktikum (Modul Nr. 2) , Werkstoffe 1 (Modul Nr. 6), Mathematik 1+2 (Module Nr. 3 +7)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Packaging (Electronics Packaging)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Packaging (Electronics Packaging)		PA	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Thomas Peterreins		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Thomas Peterreins		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ol style="list-style-type: none">1. Aufgaben des Packaging2. Tendenzen im Packaging: Rent's Rule, Wafer Level Packaging, Chip Size Packaging, Stacking3. Materialien im Packaging<ol style="list-style-type: none">3.1. Kunststoffe, Keramik, Gläser und Metalle im Packaging3.2. Materialdaten: thermischer Ausdehnungskoeffizient, Glasübergangstemperatur, Wärmeleitfähigkeit, Dielektrizitätskonstante, Hochfrequenzverluste4. Einblick in die Fügetechnik<ol style="list-style-type: none">4.1. Kleben: Klebstoffe, Verfahren, Regeln für gute Klebung4.2. Löten: Lote, Verfahren, Regeln für gutes Löten4.3. Andere Fügetechniken: Schweißen, Stecken, Klemmen usw.5. Prozesse im Packaging:<ol style="list-style-type: none">5.1. Preassembly: Abdünnen und Vereinzeln (Thinning and Dicing)5.2. Mechanische Befestigung: Die Bonding (Kleben, Löten)5.3. Elektrische Kontaktierung<ol style="list-style-type: none">5.3.1. Wire bonding5.3.2. Flip Chip5.3.3. Alternativen5.4. Gehäusetechnologien<ol style="list-style-type: none">5.4.1. Molden von Plastic Packages5.4.2. Genormte Gehäuseformen5.4.3. Keramische und metallische Gehäuse, Siebdruck5.5. Montage auf Leiterplatten6. Ausfallursachen von Packages, Prüf- und Testverfahren7. Thermische Auslegung von Gehäusen: Wärmeleitung, Konvektion und Strahlung, Wärmewiderstand, Wärmeübergang, Grenzwerte, aktive Kühlung (Heat Pipes, Peltierelemente)8. Besonderheiten bei hochfrequenten Signalen: Wo beginnt der „Hoch“frequenz-Bereich? Leitungen, Wellenwiderstand, Impedance Matching, low k, Verlustwinkel, Crosstalk, Frequenzmischung9. Exkursionen, Vorträge externer Referenten und/oder internes Seminar
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Überblick über Ziele, Prozesse, Materialien, Probleme und Tendenzen im Electronic Packaging („Back End“). Einblick in die Methoden der Fügetechnik (Aufbau- und Verbindungstechnik). <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Thermische Berechnungen für eindimensionale Geometrie im stationären Zustand.• Umgang mit hochfrequenztechnischen Größen. <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Die Studierenden erkennen, wie Back End und Wafer Processing („Front End“) bei modernen Bauelementen verzahnt sind.• Sie können ein Package im Hinblick auf Funktion, Kosten, Zuverlässigkeit und Zukunftstauglichkeit in den Grundzügen beurteilen.

Angebotene Lehrunterlagen
Skript
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
Ergänzend zum Skript wird folgende Literatur empfohlen: <ul style="list-style-type: none">• Globisch u.a., Lehrbuch Mikrotechnologie, Hanser• Harper, Electronic Packaging and Interconnection Handbook, McGraw-Hill• Tummala/Rymaszewski/Klopfenstein, Microelectronics Packaging Handbook, Academic Publishing• Hacke, Montage integrierter Schaltungen, Springer• Hanke/Scheel u.a., Baugruppentechologie der Elektronik, Verlag Technik• Habenicht, Kleben – erfolgreich und fehlerfrei, Vieweg+Teubner• Bliedtner/Gräfe, Optiktechnologie, Fachbuchverlag Leipzig und Hanser• Detlefsen/Siart, Hochfrequenztechnik, Oldenbourg• Infineon Technologies, Halbleiter• Herwig/Moschallski, Wärmeübertragung, Vieweg
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
Exkursionen, Vorträge externer Referenten/innen und/oder internes Seminar

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Physikalische Chemie mit Praktikum (Physical Chemistry with Laboratory Exercises)		PCP / Nr.25
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	2.	Pflicht	6

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Allgemeine und Anorganische Chemie (Modul Nr. 2), Werkstoffe 1 (Modul Nr. 6)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseiten
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Seminaristischer Unterricht: Ziel der Veranstaltung ist der Erwerb von thermodynamischen, kinetischen und spektroskopischen Kenntnissen sowie Kenntnisse über die Anwendung mikrotechnologischer Prozesse. Ein Beispiel hierfür ist die Berechnung der Energie bei einem Ofenprozess, die benötigt wird um eine bestimmte Halbleiterschicht mit einer bestimmten Dicke zu erhalten und diese spektroskopisch zu analysieren. Die Studierenden sind am Ende der Lehrveranstaltung in der Lage, die Reaktionsgeschwindigkeit bei einem bestimmten Halbleiterprozess zu bestimmen.</p> <p>Praktikum: Im Praktikum erwerben die Studierenden Fertigkeiten und Kompetenzen, um Problemstellungen mit Hilfe praktischer Versuche auf dem Gebiet der thermodynamischen und kinetischen Halbleiterprozesse eigenständig zu lösen. Des Weiteren können sie spektroskopische Verfahren in der Halbleitertechnik anwenden und interpretieren.</p>

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Physikalische Chemie (Physical Chemistry)	4 SWS	4
2.	Praktikum Physikalische Chemie (Laboratory Exercises: Physical Chemistry)	1 SWS	2

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Physikalische Chemie (Physical Chemistry)		PC	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Alfred Lechner		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	4

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	60h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Zulassungsvoraussetzung: das zugehörige Praktikum (Modul Nr. 25.2.) muss mit Erfolg bestanden sein.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
Gasgesetze <ul style="list-style-type: none">• Ideales Gas• Reales Gas
Thermodynamik <ul style="list-style-type: none">• 1. Hauptsatz• Volumenarbeit• Isotherme, Isobare, Isochore, adiabatische Prozesse• Thermochemie• Reaktionsenergien, Reaktionsenthalpien• 2. Hauptsatz und 3. Hauptsatz• Entropie * Gebundene Energie• Freie Reaktionsenergie und Reaktionsenthalpie
Reaktionskinetik <ul style="list-style-type: none">• verschiedene Reaktionsordnungen• Aktivierungsenergie• kinetisch und diffusionskontrollierte Prozesse
Wechselwirkung zwischen Strahlung und Materie <ul style="list-style-type: none">• Lambert - Beer• Mikrowellen - Spektroskopie• Infrarot - Spektroskopie• UV-Vis-Spektroskopie• kinetisch und diffusionskontrollierte Prozesse
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none">• Die Studierenden verfügen über thermodynamische, kinetische und spektroskopische Kenntnisse: Sie kennen die thermodynamischen Hauptsätze, verfügen über Kenntnisse in der Thermochemie und kennen Reaktionskinetiken verschiedener Ordnungen und die daraus resultierenden Aktivierungsenergien.
Kompetenzen: <ul style="list-style-type: none">• Kompetenz zur Quantitativen und Qualitativen Bestimmung von Stoffen mittels wichtiger analytische Geräte• Kompetenz zur Bestimmung und Berechnung von thermodynamischen Größen wie Reaktionswärme, freien Reaktionsenthalpien und Gleichgewichtskonstanten
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer

Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Gordon M. Barrow, Physikalische Chemie Verlag Vieweg und Verlag Bohman• Peter W. Atkins, Physikalische Chemie Verlag Wiley-VCH
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
Die Vorlesung wird von einem Praktikum und Übungen begleitet.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Praktikum Physikalische Chemie (Laboratory Exercises: Physical Chemistry)		PPC
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Alfred Lechner	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Praktikum		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	1 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
15h	45h

Studien- und Prüfungsleistung
Praktischer Leistungsnachweis (m.E.): Testat und Antest müssen für jeden Versuch bestanden sein.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Reaktionsenthalpie-Bestimmung beim Zersetzen von Wasserstoffperoxid • Bestimmung der Verbrennungsenthalpie von Ethanol mittels Kalorimetrie • Bestimmung der Geschwindigkeitskonstanten beim Verseifen Benzoesäureethylester • Bestimmung der Aktivierungsenergie bei der Ätzung von Glas mit Flusssäure
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden kennen die Wechselwirkung von Strahlung und Materie. • Sie kennen die thermodynamischen Hauptsätze und die Thermochemie. • Sie kennen den Aufbau von Batterien. • Sie verfügen über Kenntnisse der Reaktionskinetiken sowie der daraus resultierenden Aktivierungsenergien. <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Im Praktikum erlangen die Studierenden die Fertigkeiten, Problemstellungen mit Hilfe praktischer Versuche auf dem Gebiet der thermodynamischen und kinetischen Halbleiterprozesse eigenständig lösen zu können.

- Sie können spektroskopische Verfahren in der Halbleitertechnik anwenden und interpretieren.

Kompetenzen:

- Sie verfügen über die Kompetenz zur Bestimmung und Berechnung von thermodynamischen Größen wie Reaktionswärme, freien Reaktionsenthalpien und Gleichgewichtskonstanten.
- Sie sind in der Lage Spannungen mit Hilfe von Nernst-Gleichungen zu berechnen.
- Sie haben die Kompetenz zur quantitativen und qualitativen Bestimmung von Stoffen mittels wichtiger analytischer Geräte.
- Kompetenz zur Berechnung von Reaktionsordnungen, Reaktionsarten und Reaktionskonstanten und Aktivierungsenergien.

Angebote Lehrunterlagen

Skript

Lehrmedien

Zum Einsatz kommen u.a. Kalorimeter und Infrarotspektrometer sowie Apparaturen zur Bestimmung der Reaktionskinetik.

Literatur

- Gordon M. Barrow, Physikalische Chemie Verlag Vieweg und Verlag Bohman
- Peter W. Atkins, Physikalische Chemie Verlag Wiley-VCH

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen (Internship Support Module)		PBLV / Nr.21
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Manfred Hopfenmüller	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
5.	2.	Pflicht	5

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Grundlegende Kenntnisse aus der Mathematik, den Naturwissenschaften, Mess- und Schaltungstechnik sowie LabVIEW-Programmierung

Inhalte
Siehe Folgeseiten
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseiten

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen (Internship Support Module)	2 SWS	5

Hinweise zur Belegungspflicht oder zu Optionen
Die PBLV finden als Blockunterricht statt.

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Praxisbegleitende Lehrveranstaltungen (Internship Support Module)		PBLV
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Manfred Hopfenmüller	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
N.N.	in jedem Semester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht mit Übungen		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
5.	2 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Je nach Lehrveranstaltung sind Leistungsnachweise in Form von Versuchen und/oder Simulationsübungen zu erbringen. Es gilt jeweils eine Teilnahmevoraussetzung von 100%.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • LabView Programmierung • Grundlagen Messtechnik • Signalverarbeitung an Hand von Audio Signalen • Regelkreise • Bildverarbeitung • Einführung in CAD • Entwurf mechanischer Bauteile mit einem CAD Programm • Unternehmens Planspiel • Simulation des Erfolgs eines Unternehmens unter dem Einfluss verschiedener Parameter
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Die während des Studiums erworbenen Kenntnisse sind an Hand von ausgewählten, besonders praxisorientierten Lehrveranstaltungen vertieft, die auf das Studiensemester in Industriebetrieben oder Laboren vorbereiten bzw. begleiten.</p> <p>Nach Abschluss des Moduls verfügen die Studierenden über folgende Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • praktische Erfahrung in der Erfassung und Analyse von Messdaten, • Kenntnisse der Bildverarbeitung, • die Befähigung zu sicherem Umgang mit Gefahrstoffen,

- die Fähigkeit zu methodischem Arbeiten und
- die Einsicht in die Notwendigkeit der Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Aspekte

Angebotene Lehrunterlagen

Je nach Dozent/in

Lehrmedien

Je nach Dozent/in

Literatur

Je nach Dozent/in

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Qualitätsmanagement (Quality Management)		QM / Nr.26
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Dr. Martin Winkler (LB)	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	2.	Pflicht	3

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Sprachliche Kompetenz in Wort und Schrift, Praxiserfahrung (zumindest aus dem praktischen Studiensemester), Grundkenntnisse der Statistik und der Betriebswirtschaft.

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Qualitätsmanagement (Quality Management)	4 SWS	3

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Qualitätsmanagement (Quality Management)		QM	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Dr. Martin Winkler (LB)		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Dr. Martin Winkler (LB)		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht mit Gruppenübungen			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	4 SWS	deutsch	3

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Zulassungsvoraussetzung: Teilnahme an mindestens 4 von 6 Übungsblöcken. Bei unverschuldetem Fehlen wird ein Nachholtermin vereinbart.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<p>Grundlagen und Begriffe: Qualität, Qualitätsmanagement, Managementsystem, Prozessorientierung</p> <p>Werkzeuge und Methoden: Statistische Methoden, Failure Modes and Effects Analysis (FMEA), Quality Function Deployment (QFD), Verbesserungs- und Problemlösungstechniken (KVP, KAIZEN, SIX SIGMA), Teamorientierte Arbeitstechniken</p> <p>Management-Systeme: ISO 9001:2015, Ausblick auf verwandte Systeme (u.a. Umwelt, Arbeitssicherheit), Aspekte der Produkthaftung und Wirtschaftlichkeit von Management-Systemen, Audits nach ISO 19011, Zertifizierung von Management-Systemen</p> <p>Umfassendes Qualitätsmanagement (TQM - Total Quality Management): Grundlagen und Geschichte von TQM, Zielsetzung von TQM, Modelle zur Umsetzung und Bewertung von TQM-Systemen: Deming (Japan), Malcolm Baldrige (USA), EFQM (Europa), Vorgehen bei der Selbstbewertung, Ausblick auf verwandte Vorgehensweisen: Benchmarking, Balanced Scorecard</p>

Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse: <ul style="list-style-type: none">• Die Teilnehmer/innen kennen die grundlegenden Begriffe und wichtigsten Methoden des Qualitätsmanagements unter besonderer Berücksichtigung des ganzheitlichen Ansatzes von Total Quality Management (TQM).
Fertigkeiten: <ul style="list-style-type: none">• Sie können im betrieblichen Alltag beim Einsatz der wesentlichen QM-Methoden mitwirken.
Kompetenzen: <ul style="list-style-type: none">• Die Studierenden verstehen die Notwendigkeit systematischen Qualitätsmanagements.• Die Basis zur eigenständigen Vertiefung ist vorhanden.
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Bläsing, Praxishandbuch Qualitätssicherung, Band 2, Baustein F1, Mai 1987• Crosby, Ph. B., Quality Is Free, New York 1979• Crosby, Ph. B., Quality Without Tears, New York 1984• DGQ-Band 13-21, Quality Function Deployment, Beuth Verlag Berlin 2001• Diemer, R., Memory-Moderation (DGQ-Band 15-51), Beuth Verlag 1996• Hammer, Michael, Das prozesszentrierte Unternehmen, Campus Verlag• Hering, E., Triemel, J., Blank, H.-P., Qualitätssicherung für Ingenieure, VDI-Verlag 1993• Kamiske, G. F., Brauer, J.-P., Qualitätsmanagement von A – Z, 1999• Pfeifer, T., Qualitätsmanagement, Hanser Verlag München 1993• Rehbehn, R., Yurdakul, Z., Produktivität durch Qualität mit Six Sigma zur Business Excellence, Wiley/VCH, Weinh. 2002• Revelle, J. B., John W. Moran, Charles A. Cox, The QFD Handbook (engl.), Wiley, 1998• Rinne, H.; Mittag H. J., Statistische Methoden der Qualitätssicherung, Hanser Verlag München 1989• Schmelzer/Sesselmann, Geschäftsprozessmanagement in der Praxis, Hanser Verlag• Taguchi, Genichi, Einführung in Quality Engineering, 1989, Neuauflage 2004
Weitere Informationen zur Lehrveranstaltung
Seminaristischer Unterricht mit Gruppenübungen (inkl. häuslicher Vorbereitung)

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Systemintegration und Simulation (Systems: Integration and Simulation)		SY / Nr.19
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Stephan Schlamminger	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	2.	Pflicht	6

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
Grundlegende Kenntnisse aus der Physik und Mathematik

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Systemintegration und Simulation (Systems: Integration and Simulation)	6 SWS	6

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Systemintegration und Simulation (Systems: Integration and Simulation)		SN
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Stephan Schlamminger	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Stephan Schlamminger	nur im Sommersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
4.	6 SWS	deutsch	6

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
90h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten Zulassungsvoraussetzung: Teilnahme an 4 von 6 Simulationsübungen
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Aufbau und Integration von Mikrosystemen • Optoelektronische Mikrosysteme • Verbindungstechniken • Theoretische und experimentelle Systemanalyse • Mathematische Modelle und rechnergestützte Simulation von Mikrosystemen • Einführung in den CMOS Schaltungsentwurf
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kenntnisse über die Probleme und Lösungskonzepte bei der Integration mikroelektrischer, mechanischer und optischer Komponenten. • Kenntnisse der Methoden zum Entwerfen, Modellieren, Simulieren und Testen von heterogenen Mikrosystemen. • Kenntnisse der Methoden des Entwurfes integrierter Schaltungen. <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompetenz der ganzheitlich-systematischen Denkweise der Systemtechnik.

Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer
Literatur
<ul style="list-style-type: none">• Völklein, Zetterer: „Praxiswissen Mikrosystemtechnik“, Vieweg (2. Auflage 2006)• Kahlert: „Simulation technischer Systeme“, Vieweg (2004)• Brychta, Müller: „Technische Simulation“, Vogel (2004)• Gerlach, Dötzel: „Einführung in die Mikrosystemtechnik“, Hanser (2006)• Mescheder: „Mikrosystemtechnik“, Teubner (2. Auflage: 2004)• Hertwig, Brück: „Entwurf digitaler Systeme“, Hanser (2000)• Siemers: „Hardware Modellierung“, Hanser (2001)

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Technische Physik 2 mit Praktikum (Engineering Physics with Laboratory Exercises)		TP2P / Nr.10
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Peter Bickel	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	2.	Pflicht	8

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Technische Physik 1</i> (Modul Nr. 4); vorallem Mechanik und Elektrostatik

Inhalte
Siehe Folgeseiten
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseiten

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Praktikum Technische Physik 2 (Engineering Physics 2)	2 SWS	2
2.	Technische Physik 2 (Engineering Physics 2)	6 SWS	6

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Praktikum Technische Physik 2 (Engineering Physics 2)		PTP 2	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Peter Bickel		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Peter Bickel		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Praktikum			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	2 SWS	deutsch	2

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	30h

Studien- und Prüfungsleistung
Praktischer Leistungsnachweis (m.E.): Testat und Antestat müssen für jeden Versuch bestanden sein.
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
I. Schwingungen Ursache von Schwingungen; Freie und erzwungene Schwingungen; Dämpfung; Überlagerung von harmonischen Schwingungen; gekoppelte Systeme
II. Wellenlehre – Grundlagen Begriffe und Definitionen; Prinzip von Huygens; Polarisation; Wellengleichung; Ausbreitungsgeschwindigkeit, Dispersion; Überlagerung von Wellen; stehende Wellen
III. Geometrische Optik Reflexion und Brechung; optische Materialien und ihre Eigenschaften, Frequenzgang der Dielektrizitätskonstante; Abbildung durch Linsen und Spiegel; Abbildungsfehler; Linsensysteme; Hauptebenen; optische Instrumente (Auge, Brille, Lupe, Mikroskop, Fernrohr, Projektor, Kamera)
IV. Licht als elektromagnetische Welle Absorption von Licht; Beugung und Interferenz (Spalt, Gitter, Lochblende); Kohärenz; Auflösungsvermögen optischer Geräte und seine wellentheoretische Begrenzung
V. Akustik, Schallausbreitung
VI. Quantenoptik Lichtquantum; Dualismus Welle / Teilchen; Photoeffekt; Laser
VII. Photometrie - Grundgrößen und Berechnungen
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse:
<ul style="list-style-type: none"> Einsicht in die Universalität des Schwingungsbegriff in der modernen Physik und dessen Bedeutung in der techn. Anwendung

- Grundkenntnisse der geometrischen Optik, Eigenschaften und Einsatzgebiete optischer Materialien, sowie Kenntnis der wichtigsten optischen Instrumente
- Verständnis der Energieausbreitung durch Wellen und Beherrschung der mathematischen Methoden deren Beschreibung
- Erkenntnis der Universalität der prinzipiellen Wellenerscheinungen unabhängig vom jeweiligen Medium
- Verständnis elektromagnetischer Wellen, deren Entstehung sowie die wichtigsten quantenoptischen Erscheinungen, Dualismus von Welle und Teilchen

Fertigkeiten:

- Die Grundlagen des Verständnisses für darauf aufbauende Spezialgebiete sind geschaffen

Kompetenzen:

- Die Inhalte sind soweit internalisiert, dass sie auf für Ingenieure/innen typische komplexe Problemstellungen lösungsbezogen angewandt werden können

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Halliday / Resnick / Walker, „Physik“, Wiley-VCH
- W. Demtröder, „Experimentalphysik 1 und 2“, Springer-Verlag, Berlin
- G. Schröder, „Technische Optik“, Vogel-Verlag
- F. Kuypers, „Physik für Ingenieure 1 und 2“, Wiley-VCH
- Hering, Martin, Stohrer, „Physik für Ingenieure“, VDI Verlag, ISBN 3-18-400655-7
- Gehrtsen, „Physik“, Springer Verlag

Aufgabensammlungen:

- G. Kurz, H. Hübner, „Prüfungs- und Testaufgaben zur Physik“ Fachbuchverlag Leipzig, ISBN 3-446-22750-4
- J. Eichler, B. Schiewe, „Physikaufgaben“, Vieweg Uni-script, ISBN 3-528-04968-5
- Heinemann, Krämer, Müller, Zimmer, „Physik in Aufgaben und Lösungen“ Fachbuchverlag Leipzig, ISBN 3-446-21701-0
- H. Lindner, „Physikalische Aufgaben“, Fachbuchverlag Leipzig, ISBN 3-446-21758-3

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung
Technische Physik 2 (Engineering Physics 2)		TP 2
Verantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Peter Bickel	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r	Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Peter Bickel	nur im Wintersemester	
Lehrform		
Seminaristischer Unterricht		

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
3.	6 SWS	deutsch	6

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
90h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 120 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
I. Schwingungen Ursache von Schwingungen; Freie und erzwungene Schwingungen; Dämpfung; Überlagerung von harmonischen Schwingungen; gekoppelte Systeme
II. Wellenlehre – Grundlagen Begriffe und Definitionen; Prinzip von Huygens; Polarisation; Wellengleichung; Ausbreitungsgeschwindigkeit, Dispersion; Überlagerung von Wellen; stehende Wellen
III. Geometrische Optik Reflexion und Brechung; optische Materialien und ihre Eigenschaften, Frequenzgang der Dielektrizitätskonstante; Abbildung durch Linsen und Spiegel; Abbildungsfehler; Linsensysteme; Hauptebenen; optische Instrumente (Auge, Brille, Lupe, Mikroskop, Fernrohr, Projektor, Kamera)
IV. Licht als elektromagnetische Welle Absorption von Licht; Beugung und Interferenz (Spalt, Gitter, Lochblende); Kohärenz; Auflösungsvermögen optischer Geräte und seine wellentheoretische Begrenzung
V. Akustik, Schallausbreitung
VI. Quantenoptik Lichtquantum; Dualismus Welle / Teilchen; Photoeffekt; Laser
VII. Photometrie - Grundgrößen und Berechnungen
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Kenntnisse:

- Einsicht in die Universalität des Schwingungsbegriff in der modernen Physik und dessen Bedeutung in der techn. Anwendung
- Grundkenntnisse der geometrischen Optik, Eigenschaften und Einsatzgebiete optischer Materialien, sowie Kenntnis der wichtigsten optischen Instrumente
- Verständnis der Energieausbreitung durch Wellen und Beherrschung der mathematischen Methoden deren Beschreibung
- Erkenntnis der Universalität der prinzipiellen Wellenerscheinungen unabhängig vom jeweiligen Medium
- Verständnis elektromagnetischer Wellen, deren Entstehung sowie die wichtigsten quantenoptischen Erscheinungen, Dualismus von Welle und Teilchen

Fertigkeiten:

- Die Grundlagen des Verständnisses für darauf aufbauende Spezialgebietesind geschaffen

Kompetenzen:

- Die Inhalte sind soweit internalisiert, dass sie auf für Ingenieure/innen typische komplexe Problemstellungen lösungsbezogen angewandt werden können

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Halliday / Resnick / Walker, „Physik“, Wiley-VCH
- W. Demtröder, „Experimentalphysik 1 und 2“, Springer-Verlag, Berlin
- G. Schröder, „Technische Optik“, Vogel-Verlag
- F. Kuypers, „Physik für Ingenieure 1 und 2“, Wiley-VCH
- Hering, Martin, Stohrer, „Physik für Ingenieure“, VDI Verlag , ISBN 3-18-400655-7
- Gehrtsen, „Physik“, Springer Verlag

Aufgabensammlungen:

- G.Kurz, H. Hübner, „Prüfungs- und Testaufgaben zur Physik“ Fachbuchverlag Leipzig, ISBN 3-446-22750-4
- J. Eichler, B. Schiewe, „Physikaufgaben“, Vieweg Uni-script, ISBN 3-528-04968-5
- Heinemann, Krämer, Müller, Zimmer, „Physik in Aufgaben und Lösungen“ Fachbuchverlag Leipzig, ISBN 3-446-21701-0
- H. Lindner, „Physikalische Aufgaben“, Fachbuchverlag Leipzig, ISBN 3-446-21758-3

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.	
Vakuumtechnik (Vacuum Physics and Technology)		VT / Nr.30	
Modulverantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Thomas Peterreins		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	2.	Pflicht	5

Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Technische Physik 1 (Modul Nr. 4), Werkstoffe 1, Mikroelektroniktechnologie mit Praktikum (1. Teil) (Modul Nr. 11)</i>

Inhalte
Physikalische Vorgänge im Vakuum; Technik der Vakuumerzeugung und -messung
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Fundiertes Verständnis des Einflusses vakuumtechnischer Größen auf mikrotechnologische Prozesse und Analyseverfahren

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Vakuumtechnik (Vacuum Physics and Technology)	4 SWS	5

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Vakuumtechnik (Vacuum Physics and Technology)		VT	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Thomas Peterreins		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Thomas Peterreins		nur im Wintersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht mit Übungen			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
7.	4 SWS	deutsch	5

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
60h	90h

Studien- und Prüfungsleistung
Schriftliche Prüfung 90 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ol style="list-style-type: none">1. Bedeutung und historische Entwicklung der Vakuumtechnik2. Grundbegriffe: Totaldruck, Partialdruck, Enddruck, Dampfdruck, Saugvermögen, Saugleistung, Gasflussraten, Einheiten3. Vakuumphysik<ol style="list-style-type: none">3.1. Ideales Gasgesetz3.2. Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung, mittlere freie Weglänge, Flächenstoßrate, Bedeckungszeit3.3. Transportvorgänge im Vakuum: Viskosität und Wärmeleitung3.4. Strömungen: viskose und Molekularströmung, Hagen-Poiseuille-Gesetz, Knudsen-Zahl, Verblockung3.5. Leitwerte3.6. Oberflächen im Vakuum: Physisorption, Chemisorption, Ausgasen, Permeation3.7. Wachstum dünner Schichten auf Oberflächen im Vakuum4. Vakuum-Anlagen: Aufbau, Materialien, Bauelemente, Durchführungen, Flanschsysteme, Sicherheitsaspekte5. Vakuum-Erzeugung:<ol style="list-style-type: none">5.1. ölgedichtete und ölfreie Vorpumpen, Drehschieberpumpe, Membranpumpe, Schraubenpumpe, Scrollpumpe, Hubkolbenpumpe, Klauenpumpe, Sorptionspumpe5.2. HV- und UHV-Pumpen: Turbomolekularpumpe, Holweckstufen, Ionengetterpumpe, Titan-Sublimationspumpe, Kryopumpe, Diffusionspumpe, Roots Pumpe6. Druckmessung im Vakuum<ol style="list-style-type: none">6.1. Totaldruckmessung: mechanische Vakuummeter (Bourdon, McLeod), Pirani, Penning, Bayard-Alpert, Radiometer6.2. Partialdruckmessung, Massenspektrometer6.3. Lecksuche, Leckratenbestimmung7. Rechnungen zur Vakuumtechnik
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none">• Überblick über die Methoden der Vakuumerzeugung, Pumpen, Total- und Partialdruckmessung sowie Lecksuche, Bauelemente und Dichtungssysteme.• Vertrautheit mit vakuumphysikalischen Begriffen. <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• Fähigkeit zur qualifizierten Abschätzung bzw. Berechnung vakuumtechnischer Größen und Parameter. <p>Kompetenzen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Verständnis des Einflusses vakuumtechnischer Größen auf die Prozesse der Mikrotechnologie.• Befähigung zur Planung / Auslegung einer vakuumtechnischen Anlage für die Mikrotechnik.
Lehrmedien
Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- Vakuumtechnik, Berechnungen und Tabellen, Leybold AG (jetzt Oerlikon Vacuum)
- Vakuum Know-How, Pfeiffer Vacuum AG
- Jousten (Hrsg.), Wutz Handbuch Vakuumtechnik, Vieweg Verlag
- Reuschling, Konzepte und Komponenten für Vakuum-Beschichtungsanlagen, Beilage zu Vakuum in Forschung und Praxis, VCH Verlag
- Chambers/Fitch/Halliday, Basic Vacuum Technology, IOP Publishing
- Delchar, Vacuum Physics and Techniques, Chapman & Hall
- Nigel S. Harris, Modern Vacuum Practice
- Pupp/Hartmann, Vakuumtechnik, Hanser Verlag
- Lafferty, Foundations of Vacuum Science and Technology, Wiley-Interscience

Modulbezeichnung (ggf. englische Bezeichnung)		Modul-KzBez. oder Nr.
Werkstoffe 2 (Material Sciences 2)		WE2 / Nr.27
Modulverantwortliche/r	Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner	Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	

Studiensemester gemäß Studienplan	Studienabschnitt	Modultyp	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	2.	Pflicht	3

Verpflichtende Voraussetzungen
Keine
Empfohlene Vorkenntnisse
<i>Allgemeine und Anorganische Chemie mit Praktikum (Modul Nr. 2), Werkstoffe 1 (Modul Nr. 6), Elektronische Bauelemente (Modul Nr. 8)</i>

Inhalte
Siehe Folgeseite
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
Siehe Folgeseite

Zugeordnete Lehrveranstaltungen:

Nr.	Bezeichnung der Veranstaltung	Lehrumfang [SWS o. UE]	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
1.	Werkstoffe 2 (Material Sciences 2)	2 SWS	3

Lehrveranstaltung		LV-Kurzbezeichnung	
Werkstoffe 2 (Material Sciences 2)		WE 2	
Verantwortliche/r		Fakultät	
Prof. Dr. Alfred Lechner		Allgemeinwissenschaften und Mikrosystemtechnik	
Lehrende/r / Dozierende/r		Angebotsfrequenz	
Prof. Dr. Alfred Lechner		nur im Sommersemester	
Lehrform			
Seminaristischer Unterricht			

Studiensemester gemäß Studienplan	Lehrumfang [SWS oder UE]	Lehrsprache	Arbeitsaufwand [ECTS-Credits]
6.	2 SWS	deutsch	3

Zeitaufwand:

Präsenzstudium	Eigenstudium
30h	60h

Studien- und Prüfungsleistung
Klausur 60 Minuten
Zugelassene Hilfsmittel für Leistungsnachweis
Siehe Studienplantabelle

Inhalte
<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen und Nomenklatur der Organischen Chemie • Grundlegende Reaktionen der Organischen Chemie • Positiv und negativ arbeitende Lacke • Polymere Reste beim Trockenätzen • Grundlagen der OLED-Technologie
Lernziele/Lernergebnisse/Kompetenzen
<p>Kenntnisse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden kennen die Grundreaktionen der organischen Chemie • Sie kennen die in der Fotolithographie verwendeten Lacke und kennen deren Funktionsweisen. • Die Studierenden verfügen über Kenntnisse der Homo-Lumo-Übergänge in organischen fotoaktiven Schichten. • Sie kennen die Funktionsweise von OLED's. <p>Fertigkeiten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Studierenden können Voraussagen über die Produkte treffen, wenn organische Edukte miteinander reagieren. • Sie können positiv und negativ arbeitende Lacke in der Mikrotechnologie anwenden.

Kompetenzen:

- Sie können entscheiden welche Lacke für eine bestimmte Chip-Technologie am besten geeignet sind.
- Sie sind in der Lage, geeignete organische Halbleiterschichten für organische LEDs oder organische Fotodioden für eine bestimmte Anwendung auszuwählen.

Angebotene Lehrunterlagen

Skript

Lehrmedien

Tafel, Notebook, Beamer

Literatur

- B.Morrison/Boyd, Lehrbuch der Organischen Chemie, VCH Verlag.
- Bargel/Schulze, Werkstoffkunde, VDI Verlag
- E. Ivers-Tiffée, W. von Münch, Werkstoffe der Elektrotechnik, Teubner Verlag, Stuttgart, 2004
- T.L. Brown, H.E. LeMay, B.B. Bursteb, Chemie, die zentrale Wissenschaft, Pearson Studium, 10. Auflage